



Gowin 云源软件快速入门指南

SUG918-1.1.1, 2020-10-21

版权所有© 2020 广东高云半导体科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些档进行适时的更新。

版本信息

日期	版本	说明
2020/05/07	1.0	初始版本。
2020/09/07	1.1	<ul style="list-style-type: none">● 新增文件加密；● 新增查看 RTL 原理图；● 新增 tcl 命令使用。
2020/10/21	1.1.1	综合流程修改为以 GowinSynthesis 为例。

目录

目录	i
图目录	iii
表目录	v
1 关于本手册	1
1.1 手册内容	1
1.2 相关文档	1
1.3 术语、缩略语	1
1.4 技术支持与反馈	2
2 简介	3
2.1 设计流程简介	3
2.2 快速入门设计简介	3
3 快速入门	4
3.1 创建工程	4
3.1.1 新建工程	4
3.1.2 生成 MIPI D-PHY IP	5
3.1.3 加载文件	7
3.1.4 查看 RTL 原理图	7
3.2 GowinSynthesis 综合	8
3.2.1 参数配置	8
3.2.2 综合	9
3.3 物理约束	10
3.3.1 新建物理约束	10
3.3.2 修改物理约束	12
3.4 时序约束	12
3.4.1 新建时序约束	12
3.4.2 修改时序约束	14
3.5 GAO 配置	15
3.5.1 新建 Standard Mode GAO 配置文件	15

3.5.2 配置 Standard Mode GAO	15
3.6 GPA 配置	17
3.6.1 新建 GPA 配置文件	17
3.6.2 配置 GPA.....	18
3.7 布局布线.....	22
3.7.1 参数配置.....	22
3.7.2 运行 PnR	23
3.8 时序优化.....	25
3.8.1 时序分析.....	25
3.8.2 调整关键路径	25
3.9 比特流下载	27
3.10 GAO 采集数据	28
3.11 输出文件.....	29
3.11.1 布局布线报告.....	29
3.11.2 端口属性报告.....	30
3.11.3 时序报告	30
3.11.4 功耗分析报告.....	31
3.12 文件加密	31
3.12.1 源文件加密	31
3.12.2 仿真文件加密.....	33
4 Tcl 命令使用	34
4.1 Tcl 命令编辑窗口	34
4.2 Tcl 命令快速入门.....	34
4.2.1 rm_file	34
4.2.2 add_file	34
4.2.3 set_file_enable.....	35
4.2.4 set_option	35
4.2.5 run.....	36
4.2.6 set_device.....	36
4.2.7 saveto	36

图目录

图 2-1 MIPI 设计整体框图	3
图 3-1 新建工程	4
图 3-2 工程目录	5
图 3-3 MIPI RX 配置	5
图 3-4 MIPI RX IP 目录	6
图 3-5 MIPI TX 配置	6
图 3-6 Design 窗口显示	7
图 3-7 加载文件	7
图 3-8 综合参数配置	8
图 3-9 Synplify Pro 的属性和指令	9
图 3-10 综合完成界面	9
图 3-11 gwsynthesis 目录	10
图 3-12 I/O 约束	11
图 3-13 物理约束显示	12
图 3-14 Clock 约束	13
图 3-15 时序报告约束	14
图 3-16 时序约束显示	14
图 3-17 新建 GAO 配置文件	15
图 3-18 触发选项配置	16
图 3-19 采样选项配置	16
图 3-20 GAO 配置文件显示	17
图 3-21 新建 GPA 配置文件	18
图 3-22 General Setting 配置	19
图 3-23 Rate Setting 配置	20
图 3-24 Clock Setting 配置	21
图 3-25 GPA 配置文件显示	22
图 3-26 布局布线参数配置	23
图 3-27 布局布线完成界面	24
图 3-28 pnr 目录	24

图 3-29 gao 目录	25
图 3-30 时序报告最大频率	25
图 3-31 时序路径显示	26
图 3-32 路径高亮显示	27
图 3-33 调整后路径显示	27
图 3-34 Programmer 界面	28
图 3-35 GAO 显示界面	28
图 3-36 GAO 波形显示	29
图 3-37 布局布线报告	29
图 3-38 端口属性报告	30
图 3-39 时序报告	31
图 3-40 功耗分析报告	31
图 3-41 Hierarchy 窗口信息显示	32
图 3-42 Pack User Design 窗口	32
图 4-1 tcl 命令编辑窗口	34

表目录

表 1-1 术语、缩略语.....	1
-------------------	---

1 关于本手册

1.1 手册内容

本手册以 MIPI 设计为例，以用户角度介绍 Gowin 云源软件的使用，旨在帮助用户快速熟悉 Gowin 云源软件的使用流程，提高设计效率。

1.2 相关文档

通过登录高云半导体网站 www.gowinsemi.com.cn 可下载、查看以下相关文档：

- [SUG100](#), Gowin 云源软件用户指南
- [SUG935](#), Gowin 设计物理约束指南
- [SUG101](#), Gowin 设计时序约束指南
- [SUG114](#), Gowin 在线逻辑分析仪用户指南
- [SUG282](#), Gowin 功耗分析工具用户指南
- [SUG502](#), Gowin Programmer 用户指南
- [SUG550](#), GowinSynthesis 用户指南

1.3 术语、缩略语

本手册中的相关术语、缩略语及相关释义如表 1-1 所示。

表 1-1 术语、缩略语

术语、缩略语	全称	含义
PnR	Place & Route	布局布线
GAO	Gowin Analyzer Oscilloscope	在线逻辑分析仪
GPA	Gowin Power Analyzer	功耗分析工具

1.4 技术支持与反馈

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网址：www.gowinsemi.com.cn

E-mail：support@gowinsemi.com

Tel: +86 755 8262 0391

2 简介

2.1 设计流程简介

Gowin 云源软件支持 Windows 和 Linux 两个版本,支持界面模式和命令行模式运行,本手册以 Windows10 版本、界面运行、MIPI 设计为例,介绍 Gowin 云源软件的快速入门方法。

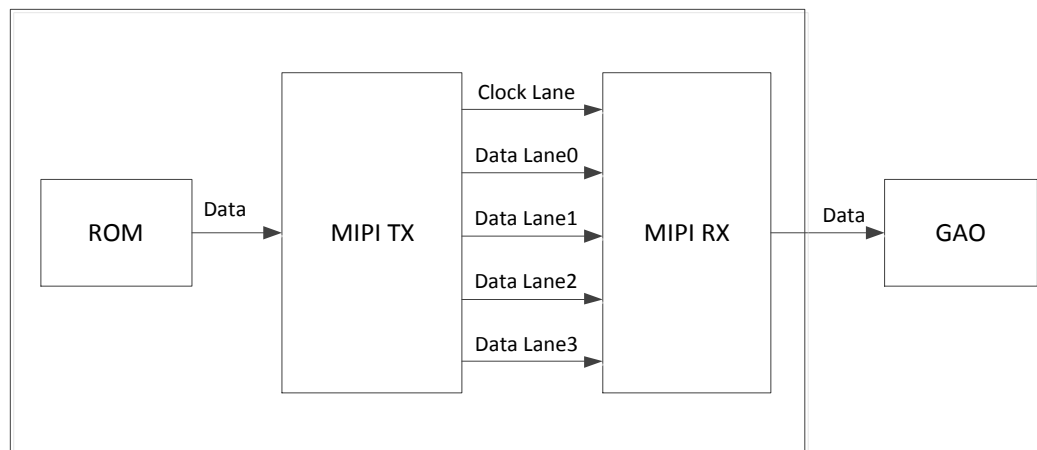
整个设计流程采用 Synplify Pro 工具综合, FloorPlanner 工具添加物理约束和时序优化, Timing Constraints Editor 添加时序约束, GAO 工具添加 GAO 配置文件和采集数据, GPA 功耗分析工具添加 GPA 配置文件, Programmer 工具进行比特流下载。

2.2 快速入门设计简介

高云 MIPI D-PHY TX RX IP 应用于串行显示接口和串行摄像头接口中,用于接收或发送图像或视频数据, MIPI D-PHY 为其提供了在物理层上的定义。

整个设计集成了 MIPI RX 和 MIPI TX 两个 IP,通过 ROM 为 MIPI TX 提供数据, MIPI TX 发送数据, MIPI RX 接收数据,最终使用 GAO 采集 MIPI RX 接收的数据,验证 MIPI RX 和 MIPI TX 的正确性,整体设计框图如图 2-1 所示。

图 2-1 MIPI 设计整体框图



3 快速入门

3.1 创建工程

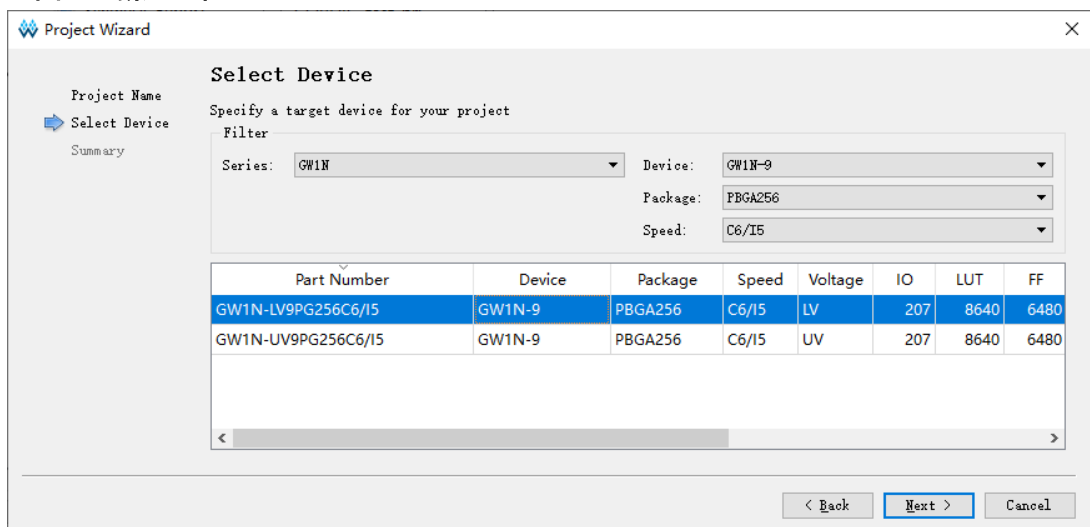
3.1.1 新建工程

打开 Gowin 云源软件，单击 Start Page 界面上“Quick Start > New Project”新建一个工程，工程名称为 MIPI_RX_TX，器件选择如图 3-1 所示：

- Series: GW1N
- Device: GW1N-9
- Package: PBGA256
- Speed: C6/I5
- Part Number: GW1N-LV9PG256C6/I5

点击“Next”，直至工程创建完成。新建工程的详细步骤请参考 [SUG100](#)，Gowin 云源软件用户指南。

图 3-1 新建工程



工程创建完成之后，在工程创建路径生成 impl 和 src 文件夹，如图 3-2 所示，其中，impl 用于放置综合后和布局布线后的文件，src 用于放置源文

件。

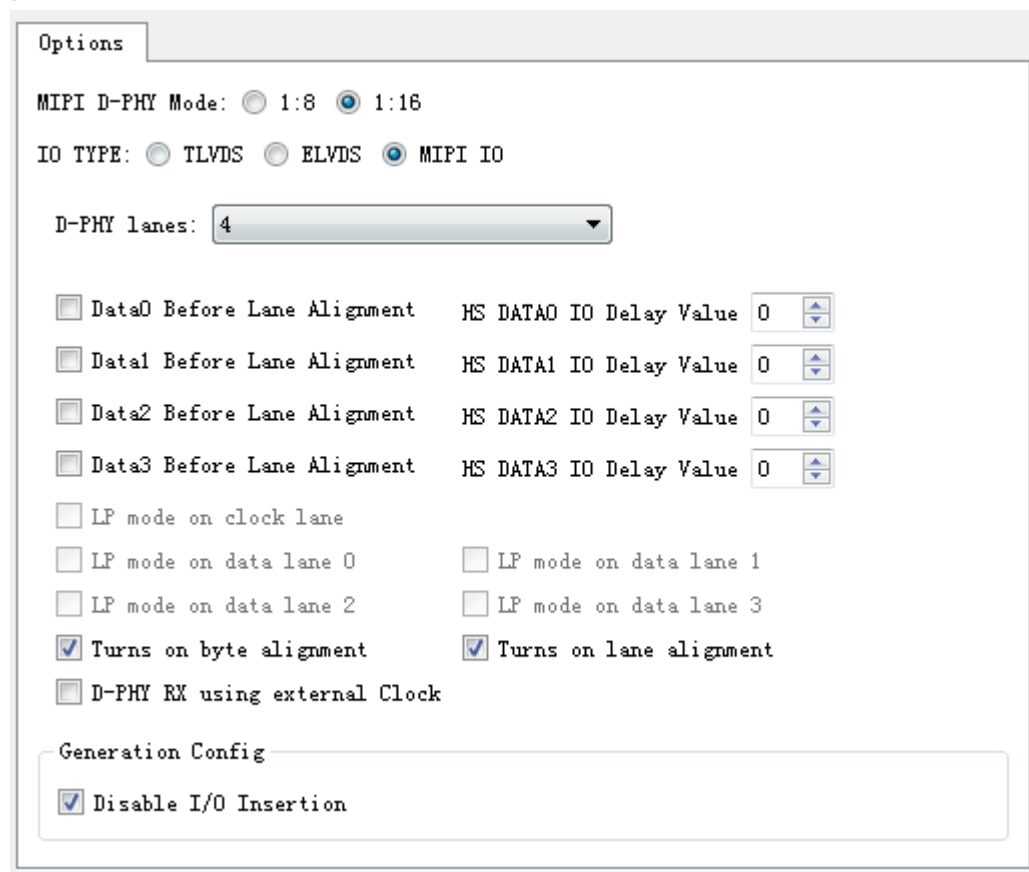
图 3-2 工程目录

Name	Date modified	Type	Size
impl	5/28/2020 4:23 PM	File folder	
src	5/8/2020 5:08 PM	File folder	
MIPI_RX_TX.gprj	5/29/2020 9:18 AM	GPRJ File	1 KB

3.1.2 生成 MIPI D-PHY IP

通过选择菜单栏“Tools > IP Core Generator”打开 IP Core Generator 界面，双击 Interface and Interconnect 将其展开，双击 MIPI RX 打开 IP Customization 界面，根据需要选择配置，本设计 MIPI RX 配置如图 3-3 所示，完成配置选择之后，点击“OK”，即可生成 MIPI RX 的 IP。

图 3-3 MIPI RX 配置



IP 生成之后，在 IP 创建路径生成 IP 设计文件及仿真所需文件，如图 3-4 所示：

- .v 文件为 IP 设计文件，其为加密形式；
- _tmp.v 文件为 IP 设计模板文件，为用户提供 IP 设计使用模板；
- .vo 文件为 IP 仿真模型文件，其为明文形式，可用于仿真；
- .ipc 文件为 IP 配置文件，用户可加载该文件修改配置；

- temp 文件夹包含生成 IP 所需的文件；
- doc、model、sim 和 tb 文件夹包含仿真所需文件，分别为说明文档、仿真模型、仿真脚本和 testbench。

注！

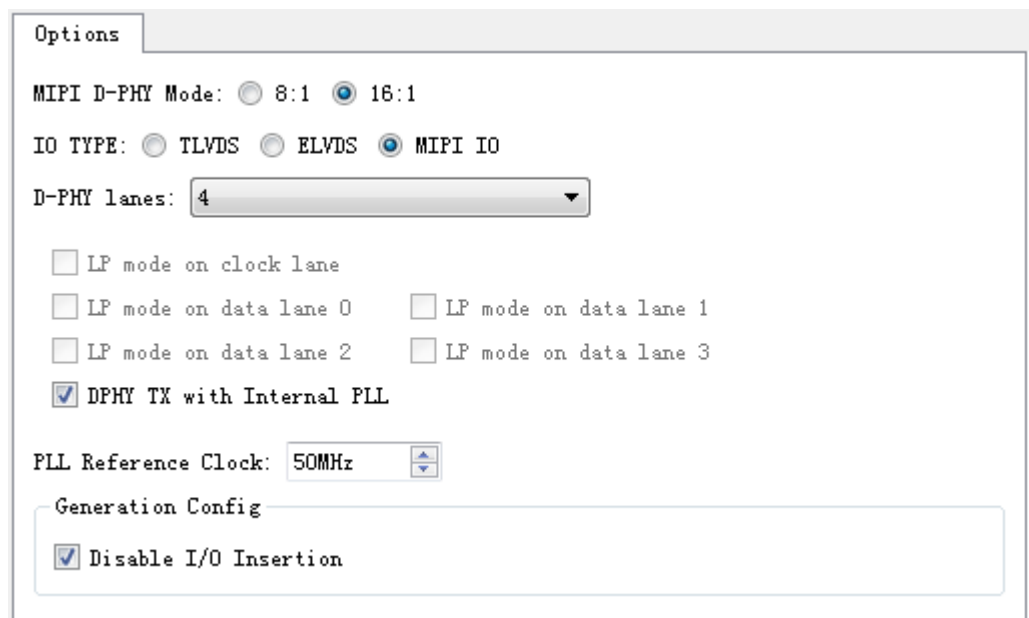
目前有些 IP，Gowin 云源软件还未提供仿真文件，IP 目录结构以实际 IP Core 生成为准。

图 3-4 MIPI RX IP 目录

Name	Date modified	Type	Size
doc	9/9/2020 4:59 PM	File folder	
model	5/7/2020 3:38 PM	File folder	
sim	5/7/2020 3:38 PM	File folder	
tb	5/7/2020 3:40 PM	File folder	
temp	9/9/2020 4:57 PM	File folder	
DPHY_RX_TOP.ipc	9/9/2020 4:57 PM	IPC File	1 KB
DPHY_RX_TOP.v	9/9/2020 4:58 PM	V File	472 KB
DPHY_RX_TOP.vo	9/9/2020 4:59 PM	VO File	860 KB
DPHY_RX_TOP_tmp.v	9/9/2020 4:58 PM	V File	3 KB

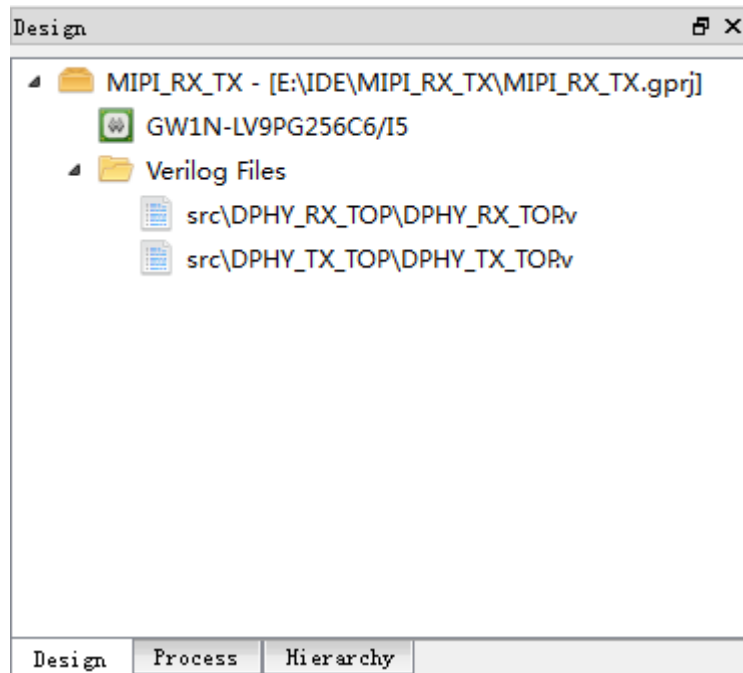
在 IP Core Generator 界面中，双击 MIPI TX 打开 IP Customization 界面，根据需要选择配置，本设计 MIPI TX 配置如图 3-5 所示，完成配置选择之后，点击“OK”，即可生成 MIPI TX 的 IP。

图 3-5 MIPI TX 配置



MIPI RX 和 MIPI TX 的 IP 生成之后，在 Design 窗口的显示如图 3-6 所示。

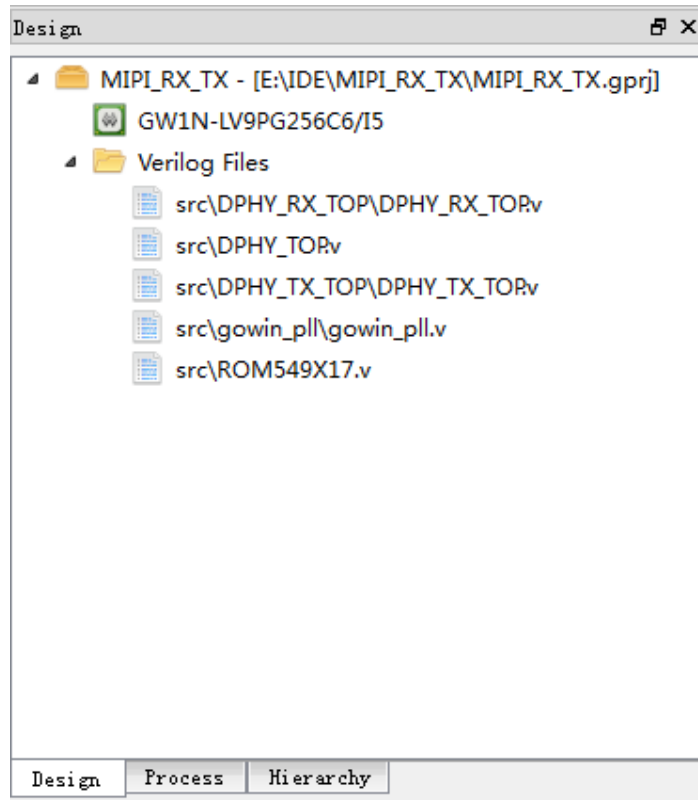
图 3-6 Design 窗口显示



3.1.3 加载文件

为测试 MIPI RX 和 MIPI TX 的功能，需新建或加载一些功能设计文件，完成之后，Design 窗口如图 3-7 所示。

图 3-7 加载文件



3.1.4 查看 RTL 原理图

源文件加载完成后，可通过菜单栏“Tools > Schemetic Viewer”查看整

个设计的原理图,帮助用户更好了解整个设计的逻辑构成。Schematic Viewer 的详细使用方法请参考 [SUG100](#), Gowin 云源软件用户指南。

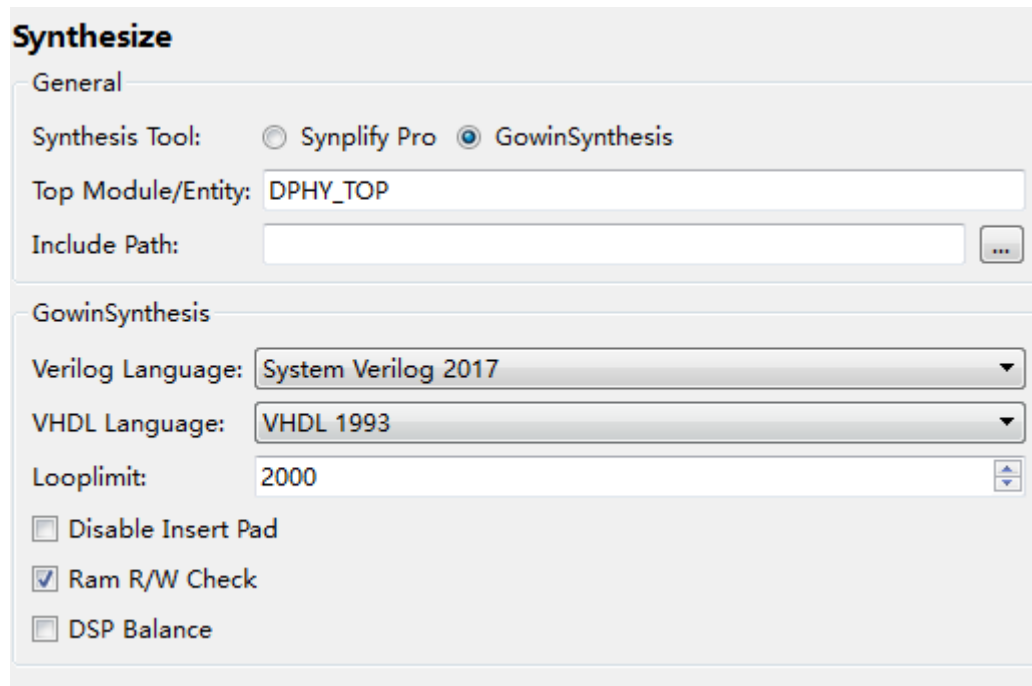
3.2 GowinSynthesis 综合

3.2.1 参数配置

选择“Process > Synthesize > Configuration”, 弹出 Configurations 对话框, 在此对话框进行综合参数配置, 关于 GowinSynthesis 所有配置の詳細说明, 可参考具体可参考 [SUG550](#), GowinSynthesis 用户指南。

本设计选择 GowinSynthesis 工具进行综合, TOP Module/Entity 设为 DPHY_TOP, 如图 3-8 所示。

图 3-8 综合参数配置



此外, 也可以通过在源文件中添加一些综合属性和指令控制综合结果, 关于属性和指令的详细说明, 可参考 [SUG550](#), GowinSynthesis 用户指南。如图 3-9 所示, 本设计中, 使用 `/* synthesis syn_keep=1 */` 综合属性, 在综合和优化过程中, 将特定 net 进行保留而不被优化。

图 3-9 Synplify Pro 的属性和指令


```

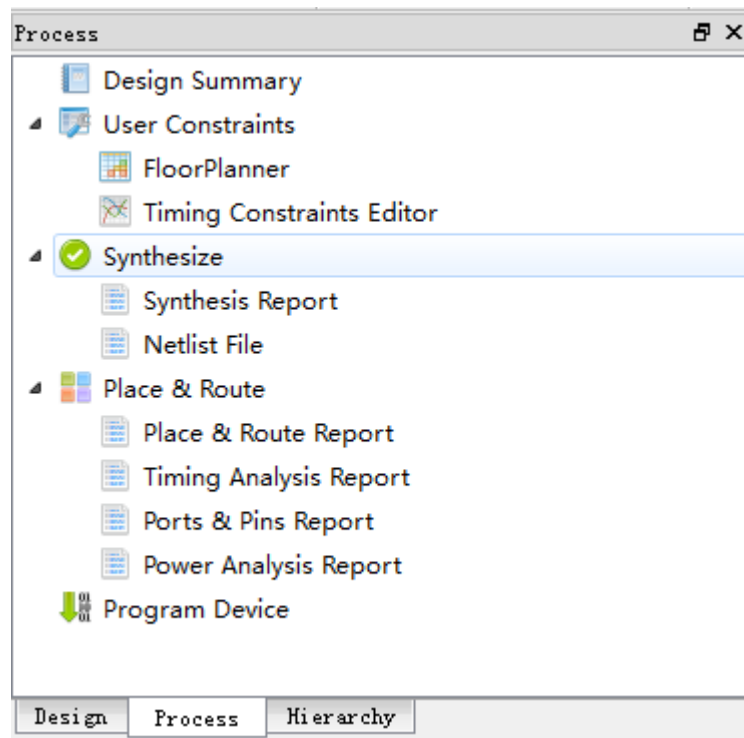
417 `ifdef GEN_MIPI_RX_16
418     reg [63:0] data_in;
419     reg [15:0] data0, data1, data2, data3;
420     reg [15:0] dout, dout1;
421     reg [15:0] data_cntr;
422     reg hactive_flag_RX;
423
424     wire [1:0] lp_clk_out,lp_data0_out;
425     wire [1:0] lp_data1_out,lp_data2_out,lp_data3_out;
426
427     wire [15:0] data_out3, data_out2, data_out1, data_out0;
428     wire D0_delay,D1_delay,D2_delay,D3_delay;
429     reg [63:0] data_out reg;
430     wire clk_byte_out/* synthesis syn_keep=1 */;
431     wire sclk_tx ;
432 `endif

```

3.2.2 综合








完成综合参数配置之后，即可进行综合。

双击 Process 窗口中的 Synthesize，开始进行综合，综合完成后，如图 3-10 所示，Synthesize 前面的图标变为“图 3-10 综合完成界面



综合完成后，在工程创建路径impl下生成 gwsynthesis 文件夹，该文件夹包含综合过程生成的所有文件，如图 3-11 所示。

图 3-11 gwsynthesis 目录

Name	Date modified	Type	Size
 gowinsyn.cfg	6/2/2020 09:59	CFG File	1 KB
 MIPI_RX_TX.log	10/21/2020 14:25	Text Document	5 KB
 MIPI_RX_TX.prj	10/21/2020 14:25	PRJ File	2 KB
 MIPI_RX_TX.vg	10/21/2020 14:25	VG File	525 KB
 MIPI_RX_TX_syn.rpt.html	10/21/2020 14:25	360 se HTML Doc...	28 KB
 MIPI_RX_TX_syn_resource.html	10/21/2020 14:25	360 se HTML Doc...	3 KB
 MIPI_RX_TX_syn_rsc.xml	10/21/2020 14:25	XML Document	1 KB

注！

如果有 Synplify Pro license, 使用 Synplify Pro 进行综合, 综合完成之后, 在工程创建路径 \impl 下生成 synthesize 文件夹, 该文件夹用于放置综合过程生成的所有文件及文件夹。

3.3 物理约束

完成综合之后, 可通过手动书写或 FloorPlanner 工具编辑物理约束, 本设计使用 FloorPlanner 工具编辑物理约束。该工具的详细使用方法请参考 [SUG935](#), Gowin 设计物理约束指南。

3.3.1 新建物理约束

选择 Gowin 云源软件 “Process > User Constraints > FloorPlanner”, 打开 FloorPlanner 工具, 该工具支持 I/O、Primitive、Group 等物理约束。本设计只添加 I/O 约束, 并以此为例。

约束编辑窗口中的 I/O 约束窗口, 可创建 I/O Constrains。在 Netlist 窗口或 I/O Constraints 窗口中选中预约束 Port 的所在行拖拽到 Package View 或 Chip Array 视图中的具体位置上, 完成后, 预约束 port 的 Location 信息变为拖拽到的 IOB 的位置, 如图 3-12 所示。

图 3-12 I/O 约束

The screenshot displays the I/O Constraints window. The top-left pane shows a Netlist tree with the following items:

- HS_DATA2_TX_P
- HS_DATA2_TX_N
- HS_DATA1_TX_P
- HS_DATA1_TX_N
- HS_DATA0_TX_P
- HS_DATA0_TX_N
- hactive_flag
- ready
- HS_CLK_RX_P
- HS_CLK_RX_N
- HS_DATA3_RX_P
- HS_DATA3_RX_N
- HS_DATA2_RX_P
- HS_DATA2_RX_N
- HS_DATA1_RX_P
- HS_DATA1_RX_N

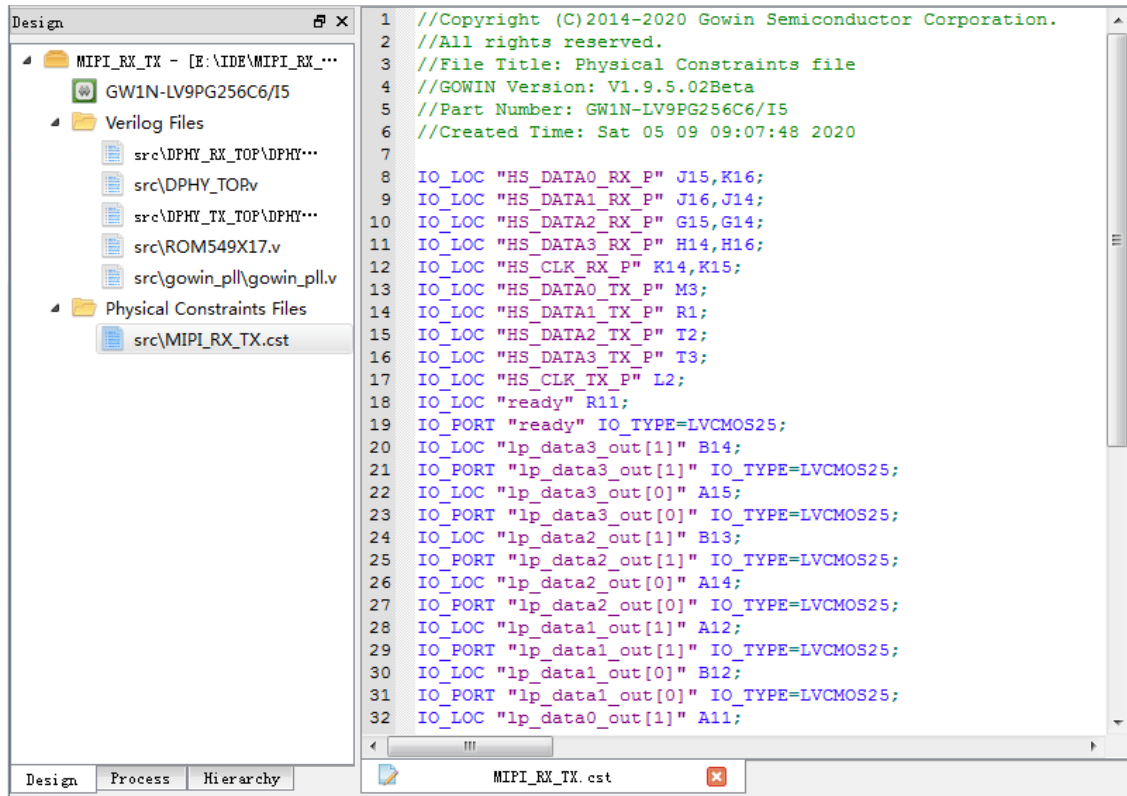
The top-right pane shows a Chip Array package view with a grid of pins. A small blue box highlights a specific pin location.

The bottom pane shows the I/O Constraints table:

	Port	Direction	Diff Pair	Location	Bank	Exclusive	IO Type
1	HS_CLK_RX_P	input	HS_CLK_RX_N	K14,K15	0	False	MIPI
2	HS_CLK_TX_P	output	HS_CLK_TX_N	L2	2	False	MIPI
3	HS_DATA0_RX_P	input	HS_DATA0_RX...	J15,K16	0	False	MIPI
4	HS_DATA0_TX_P	output	HS_DATA0_TX_N	M3	2	False	MIPI
5	HS_DATA1_RX_P	input	HS_DATA1_RX...	J16,J14	0	False	MIPI
6	HS_DATA1_TX_P	output	HS_DATA1_TX_N	R1	2	False	MIPI
7	HS_DATA2_RX_P	input	HS_DATA2_RX...	G15,G14	0	False	MIPI
8	HS_DATA2_TX_P	output	HS_DATA2_TX_N	T2	2	False	MIPI
9	HS_DATA3_RX_P	input	HS_DATA3_RX...	H14,H16	0	False	MIPI

完成所有约束编辑后，单击工具栏的“Save”，生成物理约束文件，物理约束文件在 Design 窗口和源文件编辑区的显示如图 3-13 所示。

图 3-13 物理约束显示



在布局布线阶段，如果没有物理约束文件，会自动布局布线；如果有物理约束文件，会根据物理约束文件进行布局布线。

3.3.2 修改物理约束

生成物理约束文件后，可通过 FloorPlanner 工具对物理约束进行修改，修改完成后，单击工具栏的“Save”，即可完成约束修改。

3.4 时序约束

完成综合之后，可通过手动书写或 Timing Constraints Editor 工具编辑时序约束，本设计使用时序约束编辑器工具编辑时序约束。该工具的详细使用方法请参考 [SUG101](#)，Gowin 设计时序约束指南。

3.4.1 新建时序约束

选择 Gowin 云源软件“Process > User Constraints > Timing Constrains Editor”，打开 Timing Constrains Editor 工具，该工具支持时钟、I/O、时序报告等时序约束。本设计添加时钟、时序报告约束，以此为例。

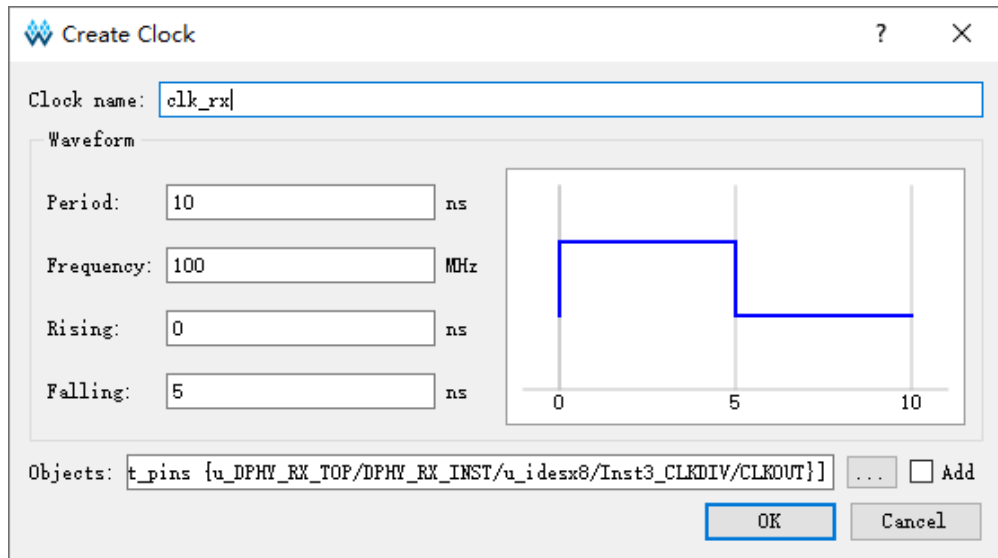
时钟约束

选中 Timing Constraints 下的 Clocks，在右侧空白处，右键单击选择 Create Clock，弹出 Create Clock 对话框，如图 3-14 所示，创建如下约束：

- Clock name: clk_rx
- Period: 10

- Rising: 0
- Falling: 5
- Source Object: get_pins
{u_DPHY_RX_TOP/DPHY_RX_INST/u_idesx8/Inst3_CLKDIV/CLKOUT}

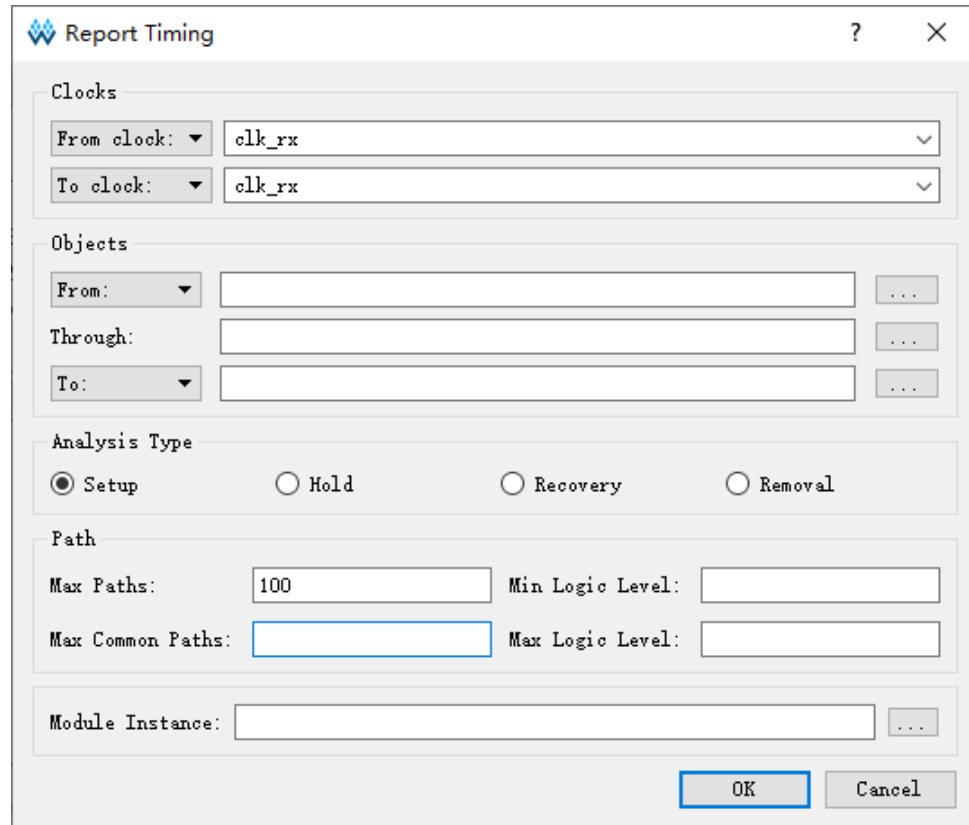
图 3-14 Clock 约束



时序报告约束

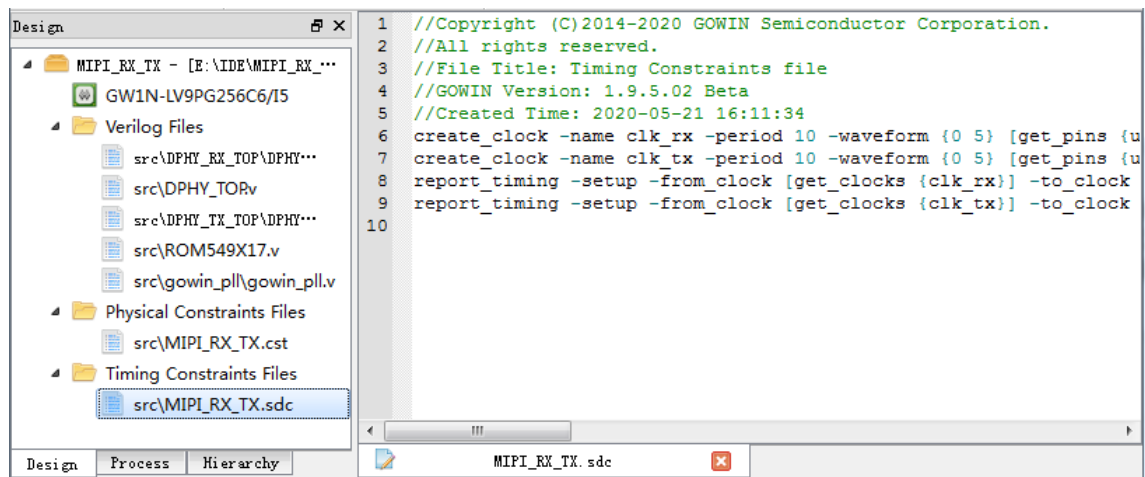
选中“Timing Constraints > Report > Report Timing”，在右侧空白处，右键单击选择 Create Report，在弹出的 Report Timing 对话框中设置参数，报告 clk_rx to clk_rx 的 setup 路径，路径条数限制 100，如图 3-15 所示。

图 3-15 时序报告约束



完成所有约束编辑后，单击工具栏的“Save”，生成时序约束，时序约束在 Design 窗口和源文件编辑区的显示如图 3-16 所示。

图 3-16 时序约束显示



在布局布线阶段，如果没有时序约束文件，会按照默认时钟进行时序分析；如果有时序约束文件，会根据时序约束文件进行时序分析。

3.4.2 修改时序约束

生成时序约束文件后，可通过 Timing Constrains Editor 工具对时序约束进行修改，修改完成后，单击工具栏的“Save”，即可完成约束修改。

3.5 GAO 配置

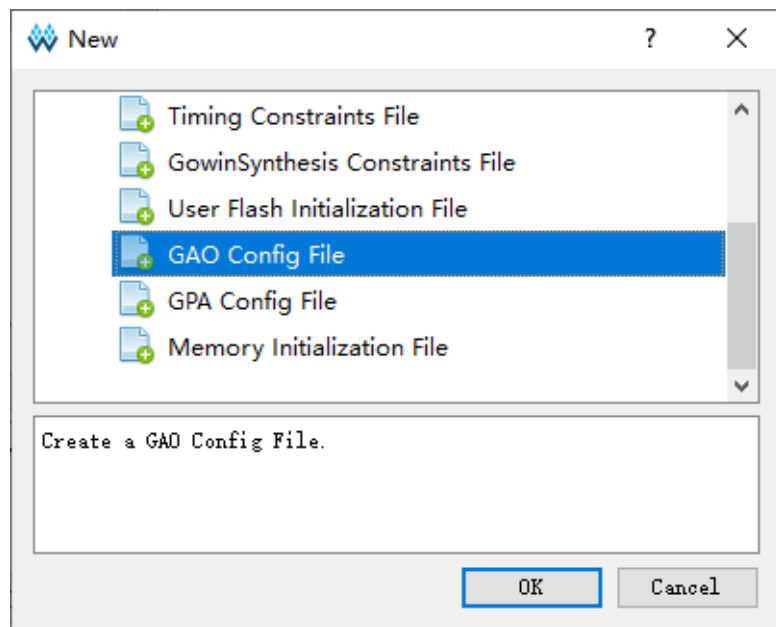
完成综合之后，可创建 GAO 配置文件，用于采集数据，验证设计的正确性。Gowin 云源软件提供 Standard Mode GAO 和 Lite Mode GAO，GAO 工具的详细使用方法请参考 [SUG114](#)，Gowin 在线逻辑分析仪用户指南。

本设计采用 Standard Mode GAO，并以此为例。

3.5.1 新建 Standard Mode GAO 配置文件

选择 Gowin 云源软件的“Design > New File...”，在弹出的 New 对话框中，选择新建一个 GAO Config File，如图 3-17 所示。单击“OK”，Type 选择 For Post-Synthesis Netlist，Mode 选择 Standard，单击“Next”，文件名定义为 MIPI_RX_TX，单击“Next”，直至 Standard Mode GAO 配置文件创建完成。

图 3-17 新建 GAO 配置文件



3.5.2 配置 Standard Mode GAO

完成 Standard Mode GAO 配置文件创建后，进行配置功能内核数量、触发选项和采样选项。触发选项包括触发条件、触发端口、匹配单元和触发表达式；采样选项包括采样信号、存储信息、采样数据信号。本设计功能内核数量为 1，触发选项配置如图 3-18 所示，采样选项配置如图 3-19 所示。

图 3-18 触发选项配置

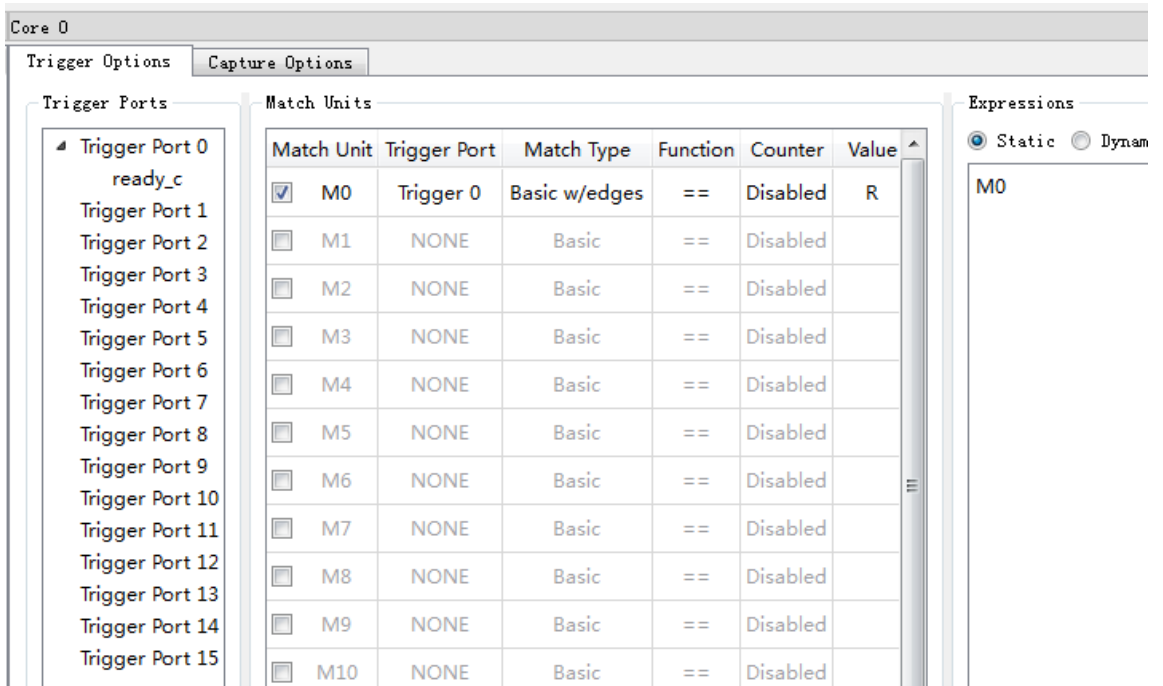
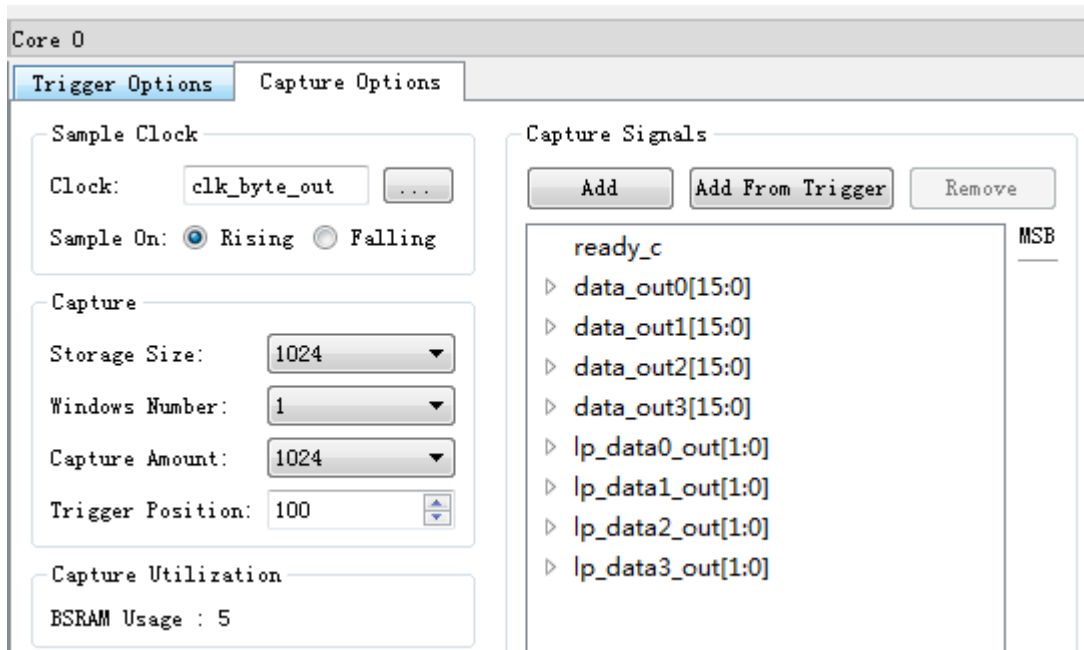
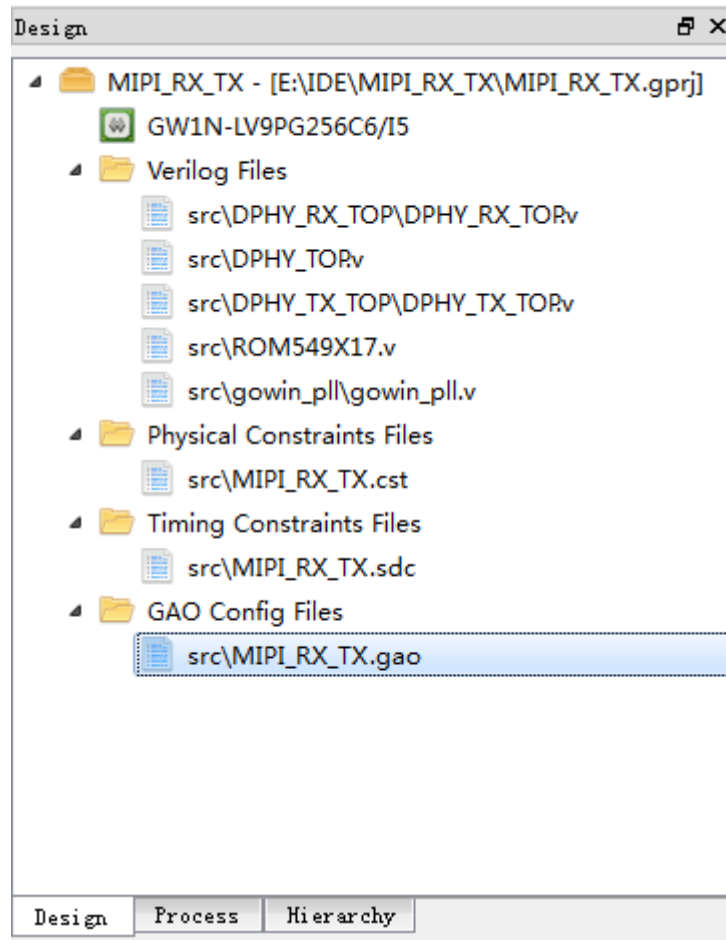


图 3-19 采样选项配置



完成所有选项配置后，单击工具栏的“Save”，即完成 Standard Mode GAO 配置文件，GAO 配置文件在 Design 窗口的显示如图 3-20 所示。

图 3-20 GAO 配置文件显示



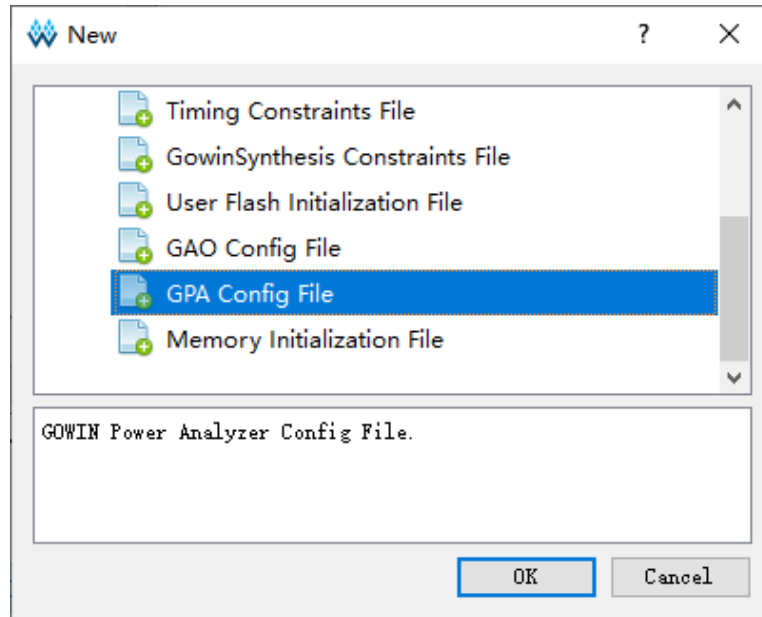
3.6 GPA 配置

完成综合之后，可创建 GPA 配置文件，用于功耗分析，帮助用户分析系统功耗。GPA 功耗分析工具的详细使用方法请参考 [SUG282](#)，Gowin 功耗分析工具用户指南。

3.6.1 新建 GPA 配置文件

选择 Gowin 云源软件的“Design > New File...”，在弹出的 New 对话框中，选择新建一个“GPA Config File”，如图 3-21 所示。单击“OK”，文件名定义为 MIPI_RX_TX，文件路径默认选择该工程下的 src 文件夹，单击“OK”，GPA 文件创建完成。

图 3-21 新建 GPA 配置文件



3.6.2 配置 GPA

完成 GPA 配置文件创建后，进行配置 **General Setting**、**Rate Setting** 和 **Clock Setting**。

- **General Setting** 包括芯片、封装、速度等级和配置温度等级、热阻抗、电压等特性参数；
- **Rate Setting** 用于信号翻转率的设置，可直接对 IO 或 Net 设置翻转率，也可以采用默认翻转；
- **Clock Setting** 主要用于配置工作时钟以及 B-SRAM、I/O 和 DFF 时钟的工作使能特性。

General Setting

本设计 **General Setting** 配置为 **COMMERCIAL** 温度等级，环境温度选择 25°C，无散热片装置，辅助电压设为 3.3V，内核电压设为 1.2V，如图 3-22 所示。

图 3-22 General Setting 配置

General Setting Rate Setting Clock Setting

Device

Device: GW1N-LV9PG256C6/I5

Operating Condition: **COMMERCIAL** Process: **TYPICAL**

Environment

Ambient Temperature: 25.000°C

Custom Theta JA: 25.000°C/W

Heat Sink

None Low Profile Medium Profile High Profile Custom

Air-flow: 0 (LFM)

Custom Theta SA: 25.000°C/W

Board Thermal Model

None Custom Typical

Board Temperature: 25.000°C (-40°C-100°C)

Custom Theta JB: 25.000°C/W

Voltage

VCC: 1.200V

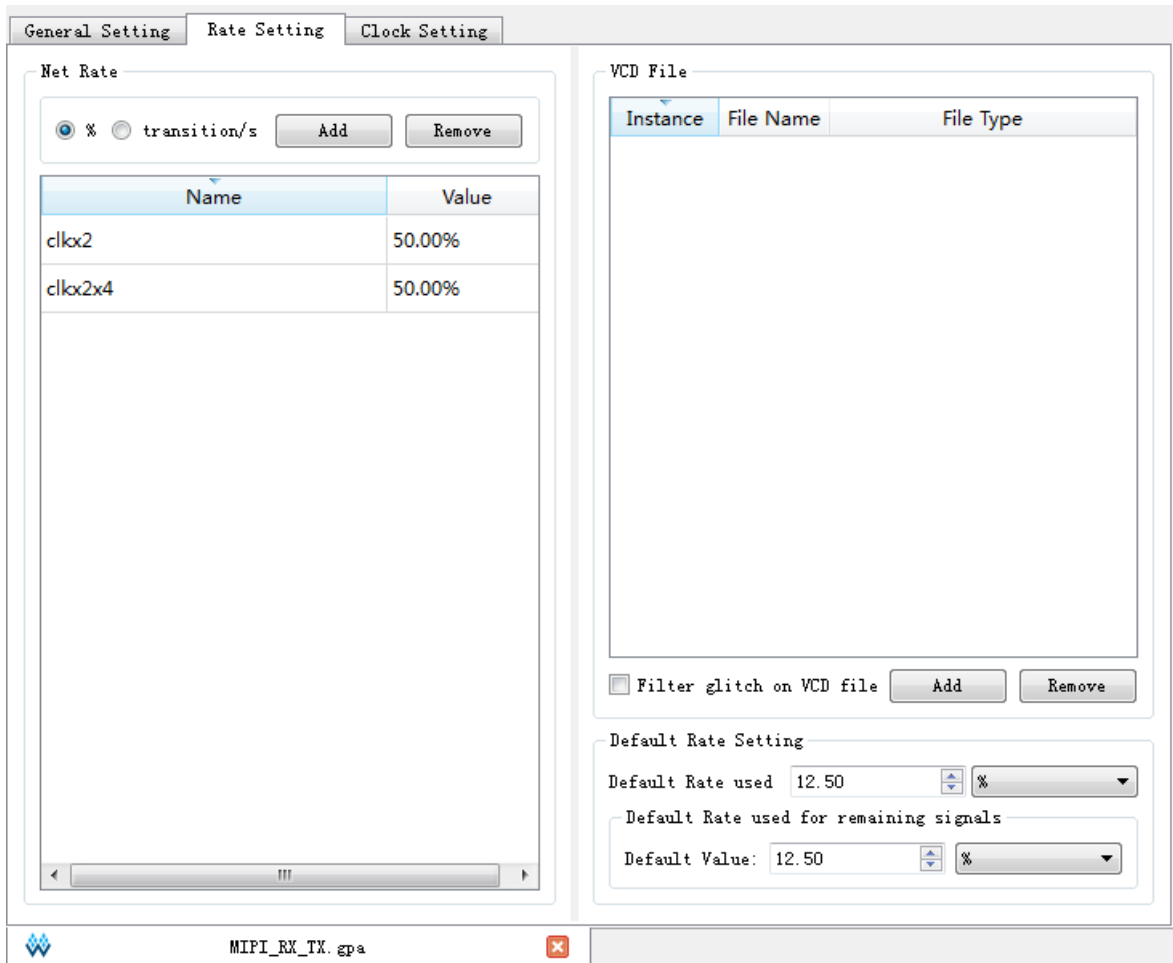
VCCX: 3.300V

MIPI_RX_TX.gpa

Rate Setting

本设计中时钟信号 `clkx2` 和 `clkx2x4` 翻转率为 50%，其余信号翻转率为全局默认翻转率 12.5%，如图 3-23 所示。

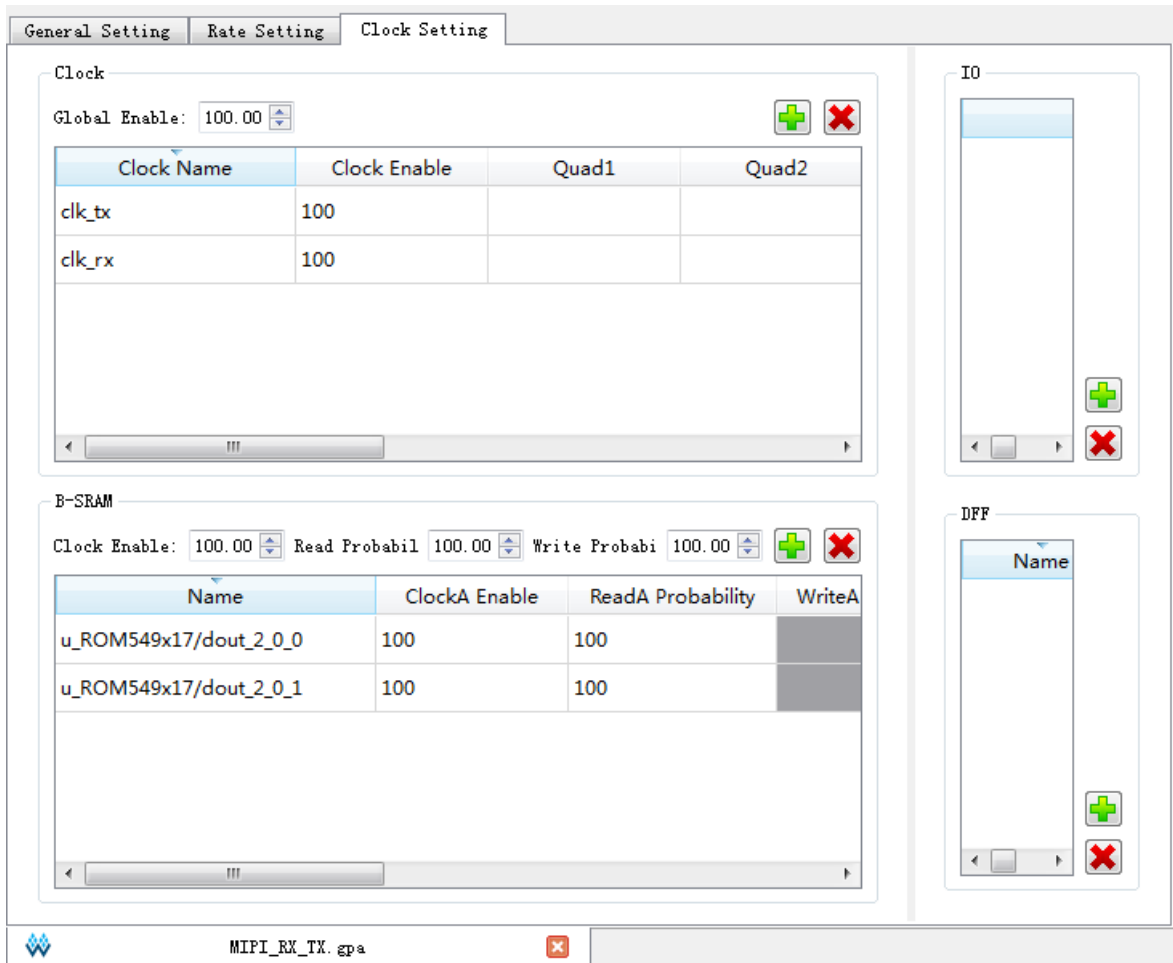
图 3-23 Rate Setting 配置



Clock Setting

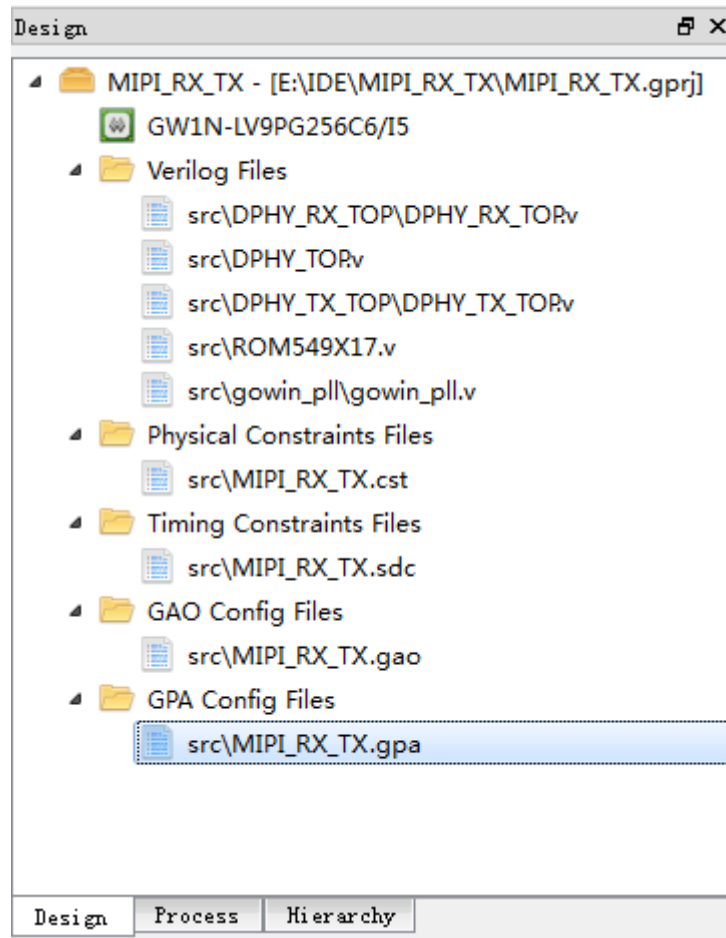
本设计 Clock 为时序分析中创建的时钟，B-SRAM 中指定了本设计所用的 pROM 的时钟使能和读取使能，其余未设置，如图 3-24 所示。

图 3-24 Clock Setting 配置



完成所有选项配置后，单击工具栏的“Save”，即完成 GPA 配置文件，GPA 配置文件在 Design 窗口的显示如图 3-25 所示。

图 3-25 GPA 配置文件显示



在布局布线阶段，如果没有 GPA 配置文件，会按照默认配置进行功耗分析；如果有 GPA 配置文件，会根据 GPA 配置文件进行功耗分析。

3.7 布局布线

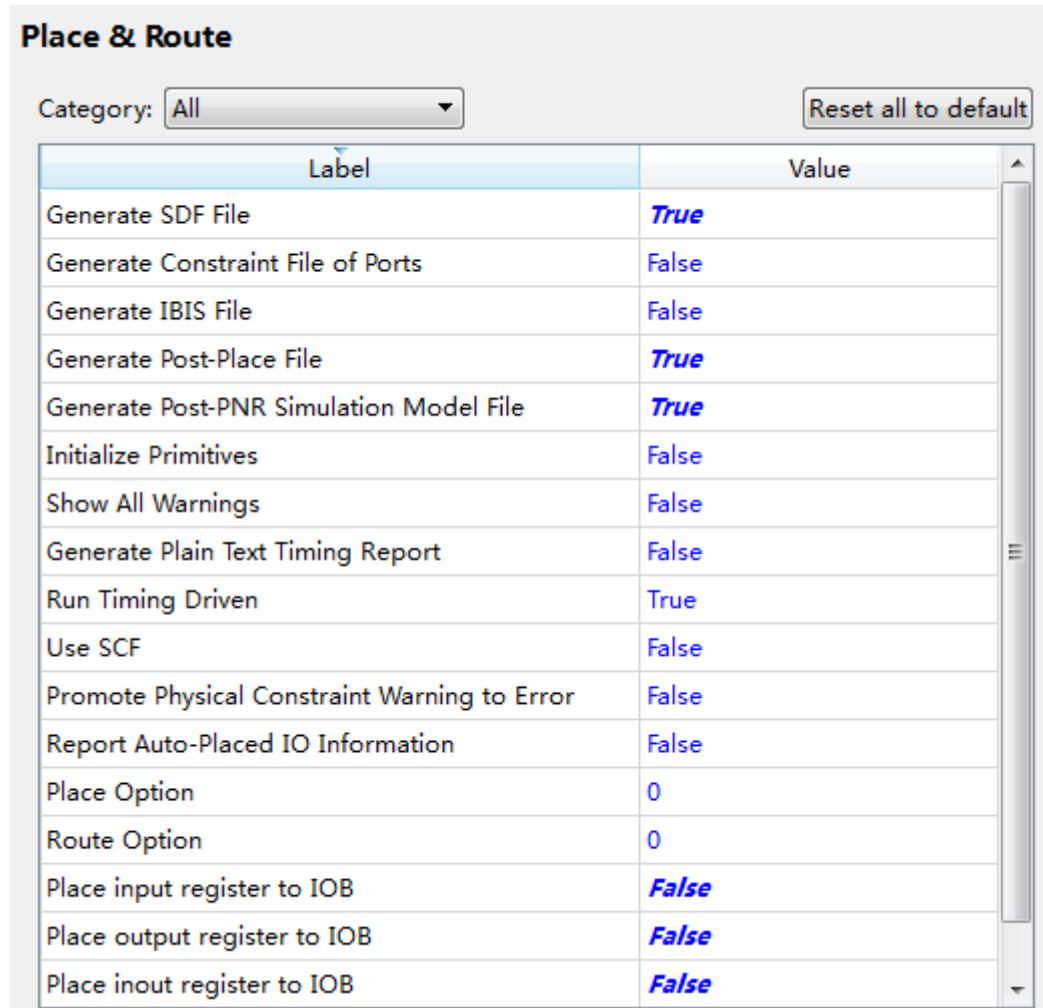
完成综合并根据用户需求创建物理约束文件、时序约束文件、GAO 配置文件以及 GPA 文件之后，即可开始布局布线。

3.7.1 参数配置

选择“Process > Place & Route > Configuration”，弹出 Configurations 对话框，在此对话框进行 General、Dual-Purpose 和 Bitstream 参数配置，参数配置的详细说明请参考 [SUG100](#)，Gowin 云源软件用户指南。

本设计布局布线参数配置，如图 3-26 所示，将 Generate SDF File、Generate Post-Place File、Generate Post-PNR Simulation Model File 配置为 True，Place input register to IOB、Place output register to IOB、Place inout register to IOB 配置为 False，其余参数采用默认配置。

图 3-26 布局布线参数配置



3.7.2 运行 PnR

完成布局布线参数配置之后，即可进行布局布线。


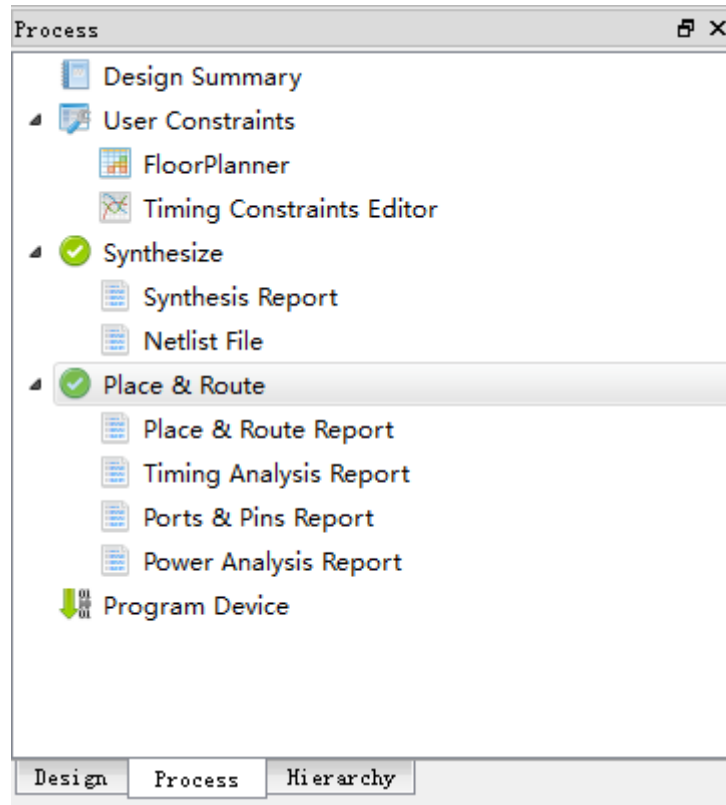
双击 **Process** 窗口中的 **Place & Route**，开始进行布局布线，布局布线时会根据物理约束进行布局布线，根据时序约束进行时序分析，根据 GAO 配置进行 GAO 的布局布线，根据 GPA 配置进行功耗分析。布局布线完成后，如图 3-27 所示，**Place & Route** 前面的图标变为“SUG918-1.1.1

图 3-27 布局布线完成界面



布局布线完成后，在工程创建路径\impl 下生成 pnr 文件夹，如图 3-28 所示，该文件夹包含布局布线过程生成的所有文件，包括比特流文件、布局布线后网表文件及输出报告等。其中，布局布线报告、端口属性报告、时序报告和功耗分析报告的详细信息参考 3.11 输出文件。

图 3-28 pnr 目录

Name	Date modified	Type	Size
ao_0.fs	9/9/2020 5:06 PM	FS File	3,476 KB
cmd.do	9/9/2020 5:05 PM	DO File	1 KB
device.cfg	9/9/2020 5:05 PM	CFG File	1 KB
MIPI_RX_TX.db	9/9/2020 5:06 PM	Data Base File	42 KB
MIPI_RX_TX.log	9/9/2020 5:06 PM	Text Document	3 KB
MIPI_RX_TX.pin.html	9/9/2020 5:06 PM	HTML Document	60 KB
MIPI_RX_TX.power.html	9/9/2020 5:06 PM	HTML Document	10 KB
MIPI_RX_TX.rpt.html	9/9/2020 5:06 PM	HTML Document	67 KB
MIPI_RX_TX.rpt.txt	9/9/2020 5:06 PM	Text Document	50 KB
MIPI_RX_TX.sdf	9/9/2020 5:06 PM	SDF File	2,668 KB
MIPI_RX_TX.timing_paths	9/9/2020 5:06 PM	TIMING_PATHS File	39 KB
MIPI_RX_TX.tr.html	9/9/2020 5:06 PM	HTML Document	1 KB
MIPI_RX_TX.vo	9/9/2020 5:06 PM	VO File	1,105 KB
MIPI_RX_TX_tr_cata.html	9/9/2020 5:06 PM	HTML Document	9 KB
MIPI_RX_TX_tr_content.html	9/9/2020 5:06 PM	HTML Document	1,192 KB

如果工程中包含 GAO 配置文件，布局布线完成后，在工程创建路径\impl 下生成 gao 文件夹，如图 3-29 所示：

- ao_0 包含功能内核的参数文件和综合结果；
- ao_control 包含控制内核的参数文件和综合结果；
- gao.v 为 GAO 综合后网表文件，其为加密形式。

图 3-29 gao 目录

Name	Date modified	Type	Size
ao_0	5/29/2020 9:19 AM	File folder	
ao_control	5/29/2020 9:19 AM	File folder	
gao.v	5/29/2020 9:19 AM	V File	318 KB

3.8 时序优化

完成布局布线之后，可以通过 FloorPlanner 工具修改物理约束或关键路径，帮助用户实现时序收敛，从而达到优化时序的目的。该工具的详细使用方法请参考 [SUG935](#)，Gowin 设计物理约束指南。

使用 FloorPlanner 进行时序优化，需要布局信息文件和时序路径信息文件，这两个文件在布局布线阶段会自动产生。

3.8.1 时序分析

布局布线之后，会生成时序报告，通过查看时序报告，如果最大频率不满足设计需求，如图 3-30 所示，clk_tx 的最大频率不满足设计需求，可通过 FloorPlanner 进行时序优化。

图 3-30 时序报告最大频率

Max Frequency Summary:					
NO.	Clock Name	Constraint	Actual Fmax	Logic Level	Entity
1	clk_rx	100.000(MHz)	90.044(MHz)	5	TOP
2	clk_tx	100.000(MHz)	151.070(MHz)	2	TOP
3	u_pll4/pll_inst/CLKOUT.default_gen_clk	3.125(MHz)	199.313(MHz)	3	TOP

3.8.2 调整关键路径

启动 FloorPlanner 工具，会自动加载布局信息文件和时序路径信息文件，加载完成后，Netlist 窗口 Timing Path 的 Setup 和 Hold 显示如图 3-31 所示。将 Chip Array 视图修改为 Show Place View > All Instance，即可高亮某条路径，如图 3-32 所示。

图 3-31 时序路径显示

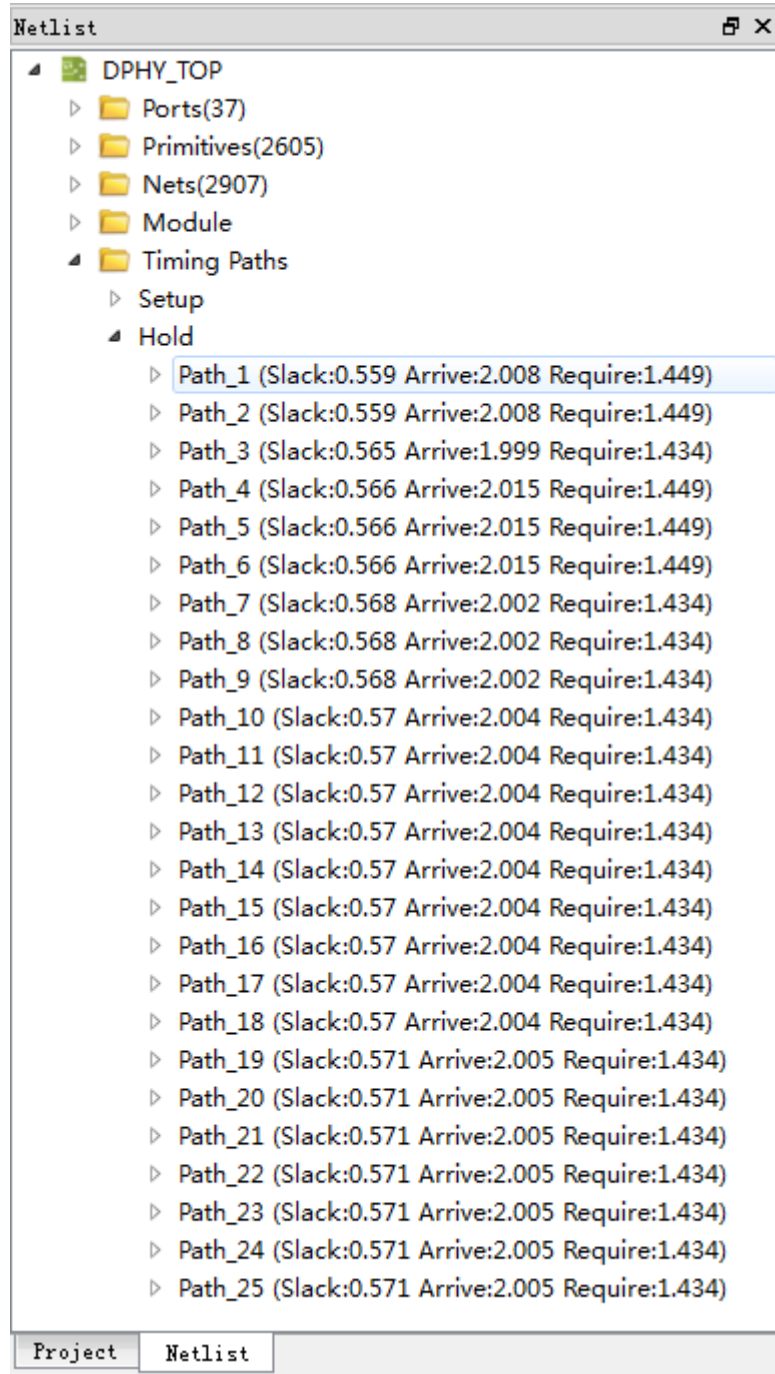


图 3-32 路径高亮显示



调整后的路径如图 3-33 所示，调整完成后，单击工具栏的“Save”，即可完成约束修改。经此调整后，如果最大频率仍不满足设计需求，可继续进行时序优化。

图 3-33 调整后路径显示



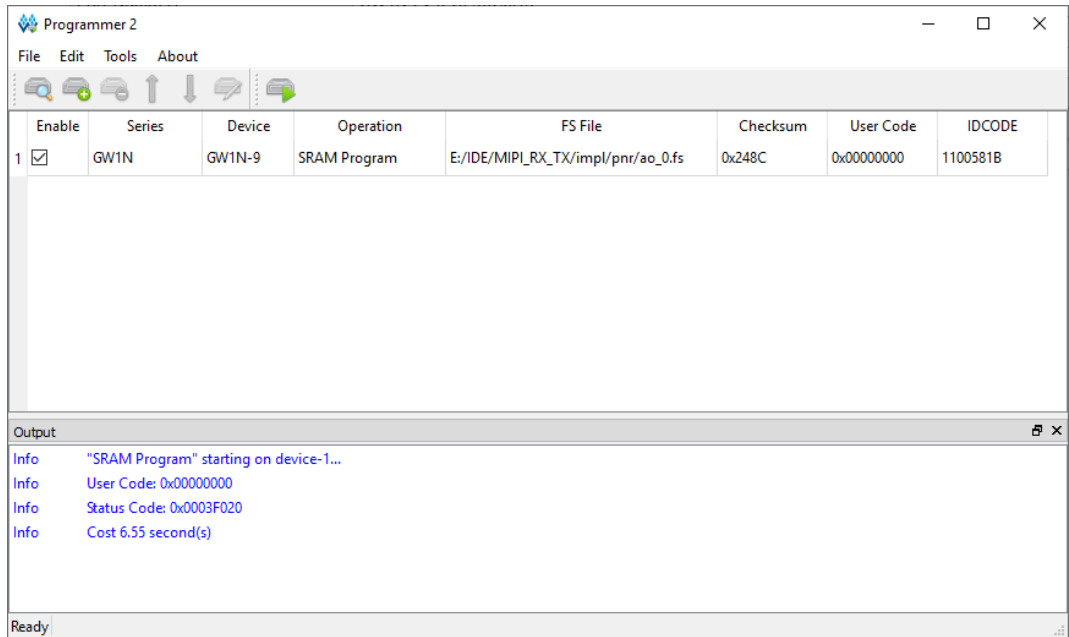
3.9 比特流下载

通过时序优化调整布局使得设计满足时序需求之后，重新布局布线，生成比特流文件，通过 Programmer 工具进行比特流下载，验证设计的正确性。该工具的详细使用方法请参考 [SUG502](#)，Gowin Programmer 用户指南。

选择“Process > Program Device”，打开 Programmer 工具，该工具自

动识别加载该工程的比特流文件。开发板准备就绪之后，单击工具栏的 **Program/Configure** 图标，即可下载比特流到开发板，比特流下载完成之后，如图 3-34 所示。

图 3-34 Programmer 界面

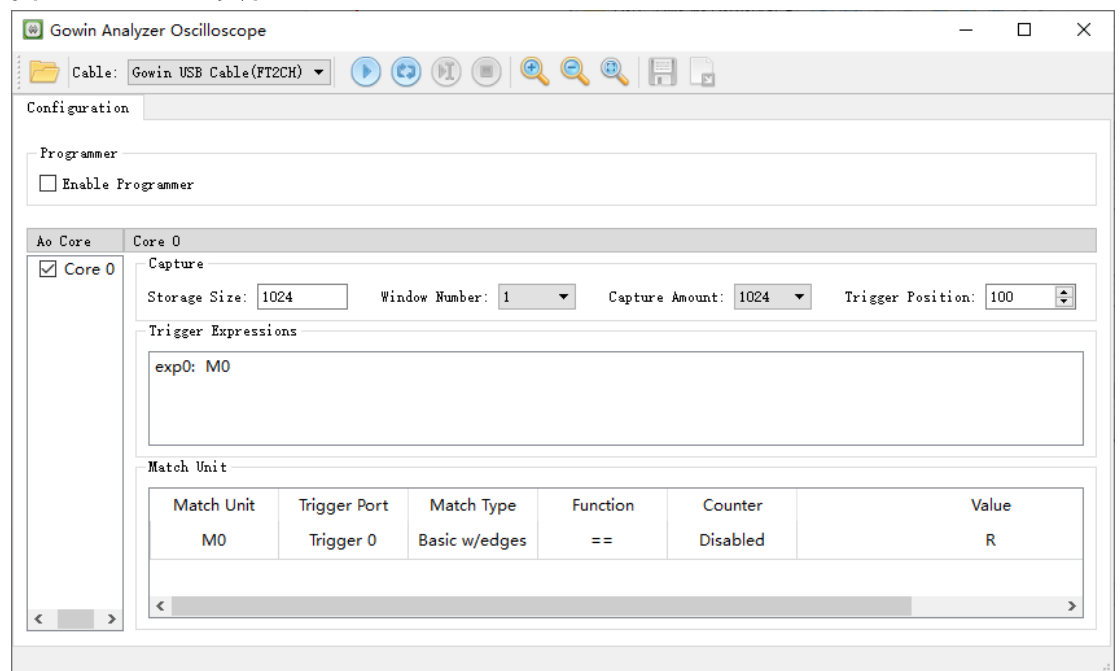


3.10 GAO 采集数据

完成比特流下载之后，可以通过 GAO 工具验证设计的正确性，GAO 工具的详细使用方法请参考 [SUG114](#)，Gowin 在线逻辑分析仪用户指南。

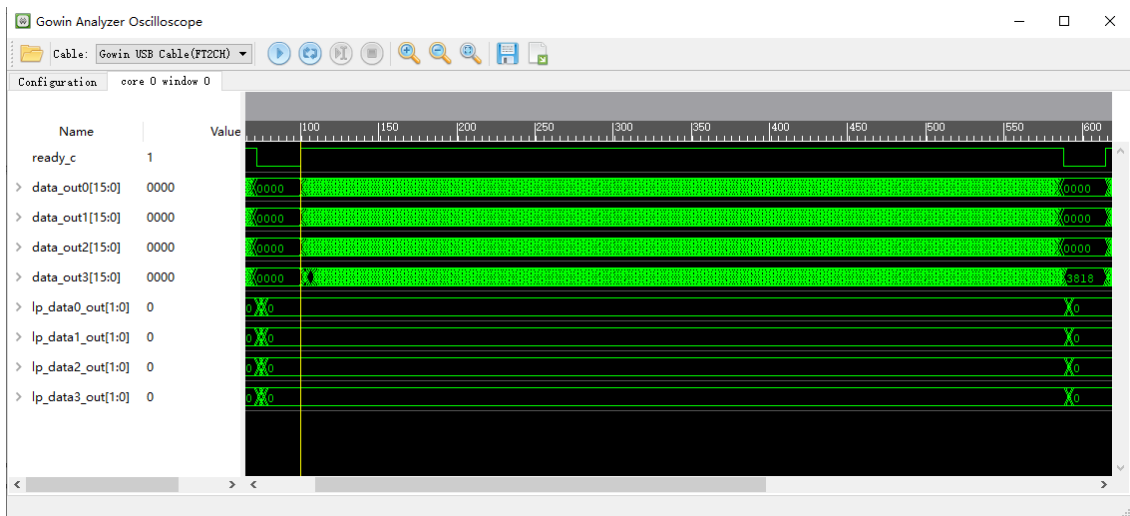
单击 Gowin 云源软件工具栏的 **Gowin Analyzer Oscilloscope** 图标，打开 GAO 显示界面，该工具自动识别加载该工程的 GAO 配置文件，如图 3-35 所示。

图 3-35 GAO 显示界面



单击 GAO 显示界面的 Start 图标，开始采集数据，采集完成之后，GAO 显示界面生成 windows 窗口用于显示波形，如图 3-36 所示，该窗口支持游标标记位置信息、波形放大缩小等操作，方便用户分析数据的正确性。

图 3-36 GAO 波形显示



3.11 输出文件

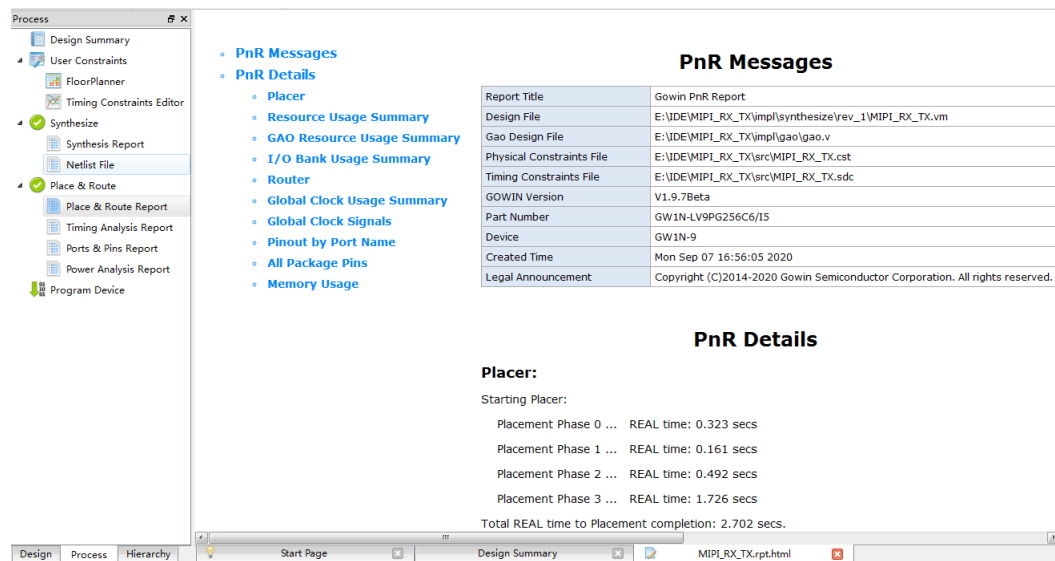
3.11.1 布局布线报告

布局布线报告，列出了用户设计占用的芯片资源信息、内存消耗信息、时间消耗信息等，方便用户了解设计的大小及与目标芯片是否匹配等内容。文件后缀名为.rpt.html，具体信息可查看*.rpt.html 文件。

用户可在 Process 窗口中的 Place & Route 区，双击“Place & Route Report”，打开布局布线报告，如图 3-37 所示。

有关布局布线报告的详细信息，请参考 [SUG100](#)，Gowin 云源软件用户指南。

图 3-37 布局布线报告



3.11.2 端口属性报告

端口属性报告,是在布局之后输出的端口属性的文件,包括端口的类型、属性及端口位置信息等,生成的文件后缀名为.pin.html,具体信息可查看*.pin.html文件。

用户可在 Process 窗口中的 Place & Route 区,双击“Ports & Pins Report”,打开端口属性报告,如图 3-38 所示。

有关端口属性报告的详细信息,请参考 [SUG100](#), Gowin 云源软件用户指南。

图 3-38 端口属性报告

Pin Messages

Report Title	Gowin Pin Report
Design File	E:\IDE\MIP1_RX_TX\impl\synthesize\rev_1\MIP1_RX_TX.vm
Physical Constraints File	E:\IDE\MIP1_RX_TX\src\MIP1_RX_TX.cst
Timing Constraints File	E:\IDE\MIP1_RX_TX\src\MIP1_RX_TX.sdc
GOWIN Version	V1.9.7Beta
Part Number	GW1N-LV9PG256C6/I5
Device	GW1N-9
Created Time	Mon Sep 07 16:56:05 2020
Legal Announcement	Copyright (C)2014-2020 Gowin Semiconductor Corporation. All rights reserved.

Pin Details

Pinout by Port Name:

Port Name	Diff Pair	Loc./Bank	Constraint	Dir.	Site	IO Type	Drive F
rstn		B3/2	Y	in	IOB12[A]	LVC MOS12	NA
clkx2x4		A9/3	Y	in	IOL9[A]	LVC MOS25	NA
lp_data0_dir_i		T14/1	Y	in	IOR4[B]	LVC MOS25	NA
HS_CLK_TX_P	HS_CLK_TX_N	L2,M1/2	Y	out	IOB29	MIP1	3.5
HS_DATA3_TX_P	HS_DATA3_TX_N	T3,R4/2	Y	out	IOB45	MIP1	3.5
HS_DATA2_TX_P	HS_DATA2_TX_N	T2,R3/2	Y	out	IOB43	MIP1	3.5
HS_DATA1_TX_P	HS_DATA1_TX_N	R1,P2/2	Y	out	IOB41	MIP1	3.5

3.11.3 时序报告

时序报告输出提供两种类型的时序报告:网页格式和文本格式,默认为网页格式。

时序报告包括建立时间检查、保持时间检查、恢复时间检查、移除时间检查、最小时钟脉冲检查、最大扇出路径、布线拥塞度报告等部分,默认情况下对上述所有检查进行报告,并提供最大频率的报告。

用户可在 Process 窗口中的 Place & Route 区,双击“Timing Analysis Report”,打开时序报告,如图 3-39 所示。

有关时序报告的详细信息,请参考 [SUG940](#) Gowin 设计时序约束指南。

图 3-39 时序报告

Timing Messages

Report Title	Gowin Timing Analysis Report
Design File	E:\IDE\MIP1_RX_TX\impl\synthesize\rev_1\MIP1_RX_TX.vm
Physical Constraints File	E:\IDE\MIP1_RX_TX\src\MIP1_RX_TX.cst
Timing Constraint File	E:\IDE\MIP1_RX_TX\src\MIP1_RX_TX.sdc
GOWIN version	V1.9.7Beta
Part Number	GW1N-LV9PG256C6/I5
Device	GW1N-9
Created Time	Mon Sep 07 16:56:05 2020
Legal Announcement	Copyright (C)2014-2020 Gowin Semiconductor Corporation. All rights reserved.

Timing Summaries

STA Tool Run Summary:

Setup Delay Model	Slow 1.14V 85C
Hold Delay Model	Fast 1.26V 0C
Numbers of Paths Analyzed	3785
Numbers of Endpoints Analyzed	3982
Numbers of Falling Endpoints	1
Numbers of Setup Violated Endpoints	0
Numbers of Hold Violated Endpoints	0

3.11.4 功耗分析报告

功耗分析报告主要是针对用户设计，根据器件的特性做一个预估的功耗计算，帮助用户评估设计的基本功耗值。

用户可在 **Process** 窗口中的 **Place & Route** 区，双击“**Power Analysis Report**”，可打开功耗分析报告，如图 3-40 所示。

有关功耗分析报告的详细信息，请参考 [SUG282](#)，Gowin 功耗分析工具用户指南。

图 3-40 功耗分析报告

Power Messages

Report Title	Gowin Power Analysis Report
Design File	E:\IDE\MIP1_RX_TX\impl\synthesize\rev_1\MIP1_RX_TX.vm
Physical Constraints File	E:\IDE\MIP1_RX_TX\src\MIP1_RX_TX.cst
Timing Constraints File	E:\IDE\MIP1_RX_TX\src\MIP1_RX_TX.sdc
GOWIN Version	V1.9.7Beta
Part Number	GW1N-LV9PG256C6/I5
Device	GW1N-9
Created Time	Mon Sep 07 16:56:05 2020
Legal Announcement	Copyright (C)2014-2020 Gowin Semiconductor Corporation. All rights reserved.

Power Summary

Power Information:

Total Power (mW)	27.774
Quiescent Power (mW)	3.572
Dynamic Power (mW)	24.202

Thermal Information:

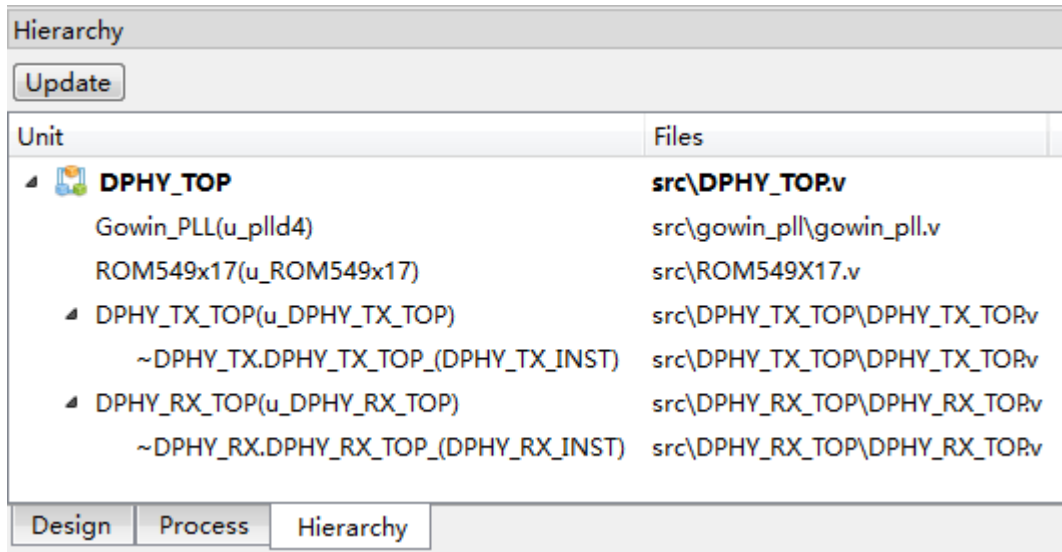
Junction Temperature	25.281
Theta JA	10.200
Max Allowd Ambient Temperature	84.717

3.12 文件加密

3.12.1 源文件加密

当用户需要加密保护源文件时，可以在建立工程后，通过 **Hierarchy** 窗口对所选 **module** 及其 **sub module** 进行加密，如图 3-41 所示。其详细使用方法请参考 [SUG100](#)，Gowin 云源软件用户指南。

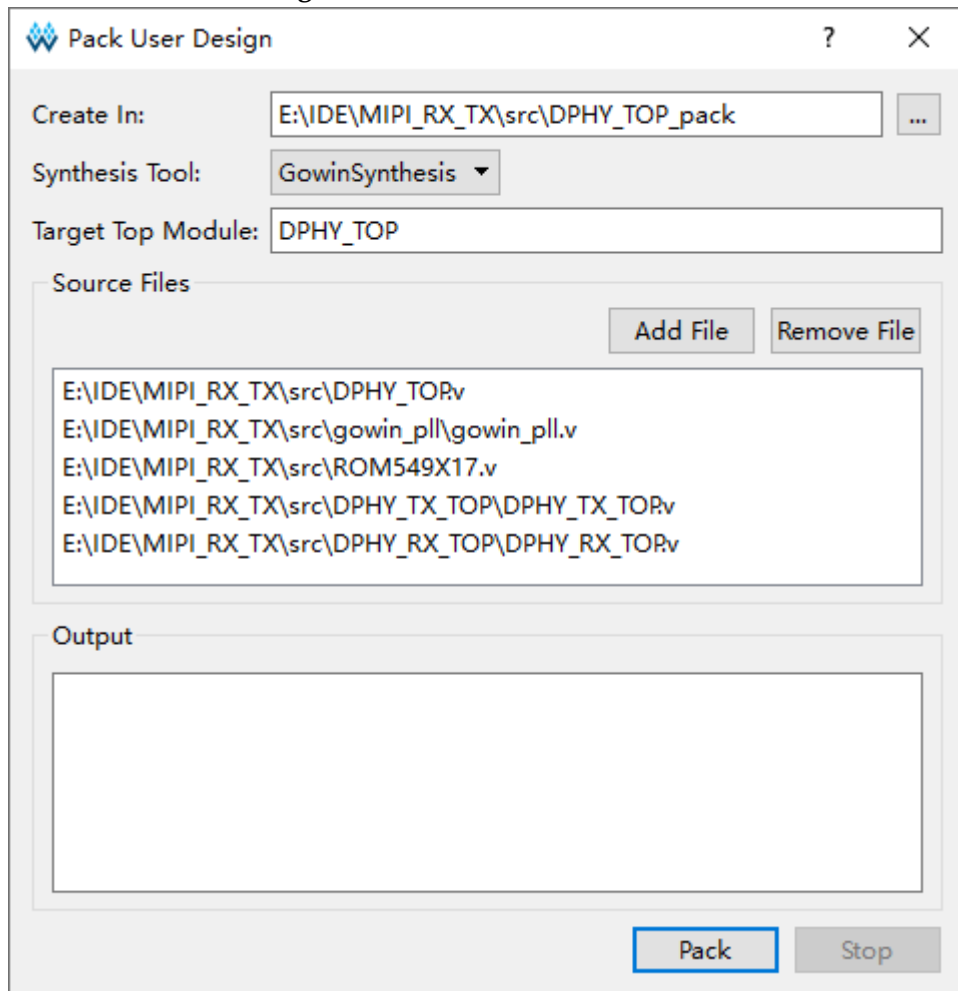
图 3-41 Hierarchy 窗口信息显示



以 module DPHY_TOP 为例介绍文件加密方法。

在 Hierarchy 窗口中右键单击 DPHY_TOP，选择右键列表中的“Pack User Design”，打开文件加密窗口，如图 3-42 所示。

图 3-42 Pack User Design 窗口



综合工具选择 GowinSynthesis, module 为 DPHY_TOP, 点击“Pack”开始执行加密, 开始加密及加密成功后会在 Output 窗口打印相关信息。

加密完成后在目标路径(E:\IDE\MIPI_RX_TX\src\DPHY_TOP_pack)下生成两个文件: DPHY_TOP_gowin.vp 和 DPHY_TOP_sim.v。

- DPHY_TOP_gowin.vp 为加密文件, 可提供给他人使用;
- DPHY_TOP_sim.v 是打平的综合后明文网表文件, 可以用于仿真。

3.12.2 仿真文件加密

高云提供的仿真文件是明文格式, 为了进一步保护仿真文件, 可将仿真文件使用第三方仿真软件进行加密, 以 modelsim 和 vcs 仿真工具对 DPHY_TOP_sim.v 加密为例进行介绍。

Modelsim 仿真工具加密

使用 modelsim 仿真时, 将仿真文件进行加密, 可通过以下步骤:

1. 在仿真文件 DPHY_TOP_sim.v 中需要加密的内容前后分别添加宏定义 `protect 和 `endprotect;
2. 运行命令: vlog +protect DPHY_TOP_sim.v;
3. 执行完命令, 会在 work 库生成 DPHY_TOP_sim.vp, 该文件为 DPHY_TOP_sim.v 加密后文件, 可用于 modelsim 仿真。

vcs 仿真工具加密

使用 vcs 仿真时, 将仿真文件进行加密, 可通过以下步骤:

1. 在仿真文件 DPHY_TOP_sim.v 中需要加密的内容前后分别添加宏定义 `protect128 和 `endprotect128;
2. 运行命令: vcs +v2k -protect128 DPHY_TOP_sim.v;
3. 执行完命令, 会在当前路径下生成 DPHY_TOP_sim.vp, 该文件为 DPHY_TOP_sim.v 加密后文件, 可用于 vcs 仿真。

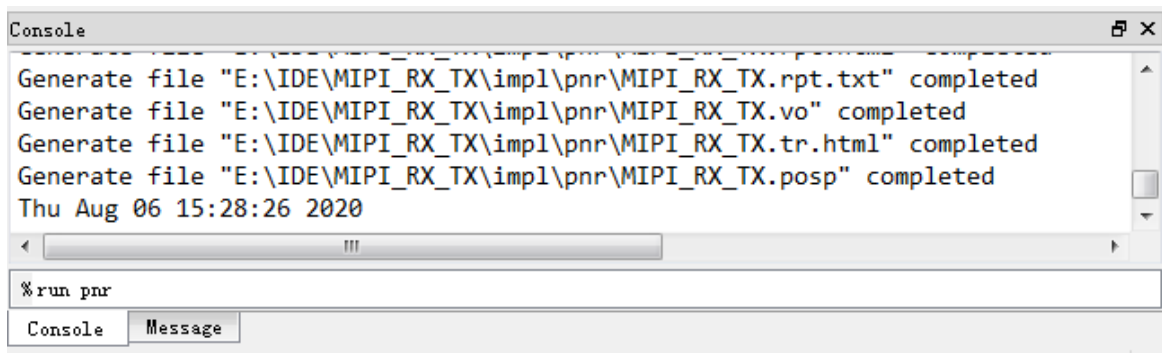
4 Tcl 命令使用

前面介绍采用界面操作实现整个设计流程的方式，云源软件还提供了 tcl 命令实现一些设置和流程，以 MIPI 设计为例介绍 tcl 命令的使用，tcl 命令的详细介绍请参考 [SUG100](#)，Gowin 云源软件用户指南附录 A。

4.1 Tcl 命令编辑窗口

在 Console 信息输出页的最下方是 tcl 命令编辑窗口，可以在窗口中输入 tcl 命令后通过回车键来执行相关命令，如图 4-1 所示。

图 4-1 tcl 命令编辑窗口



4.2 Tcl 命令快速入门

4.2.1 rm_file

rm_file 用于移除设计文件。为介绍该命令的使用，将工程中功能设计文件 ROM549X17.v 和 DPHY_TOP.v 移除该工程，用 tcl 命令实现如下：

同时移除 ROM549X17.v 和 DPHY_TOP.v

```
rm_file src/ROM549X17.v src/DPHY_TOP.v
```

执行完该命令，console 窗口会显示移除文件的提示信息，两个文件不显示在 design 窗口。

4.2.2 add_file

add_file 用于添加设计文件。为介绍该命令的使用，将被移除的功能设计文件 ROM549X17.v 和 DPHY_TOP.v 重新添加到工程，用 tcl 命令实现如下：

同时添加 ROM549X17.v 和 DPHY_TOP.v

```
add_file src/ROM549X17.v src/DPHY_TOP.v
```

执行完该命令，console 窗口会显示添加文件的提示信息，两个文件显示在 design 窗口。

4.2.3 set_file_enable

set_file_enable 用于设置文件是否可以被使用。为介绍该命令的使用，先将设计中的 DPHY_TOP.v 修改为 disable 状态，然后再将其改为 enable 状态，用 tcl 命令实现如下：

将 DPHY_TOP.v 修改为 disable 状态

```
set_file_enable src/DPHY_TOP.v false
```

执行完该命令后，console 窗口会显示 disable 文件的提示信息，design 窗口 DPHY_TOP.v 文件被置灰。

将 DPHY_TOP.v 修改为 enable 状态

```
set_file_enable src/DPHY_TOP.v true
```

执行完该命令后，console 窗口会显示 enable 文件的提示信息，design 窗口 DPHY_TOP.v 文件显示为可用状态。

4.2.4 set_option

set_option 用于设置工程相关的属性配置及流程选项。本设计中的综合和布局布线的参数配置，用 tcl 命令实现如下：

- 综合工具选择 GowinSynthesis

```
set_option -synthesis_tool gowinsynthesis
```
- TOP Module/Entity 设为 DPHY_TOP

```
set_option -top_module DPHY_TOP
```
- Generate SDF File 配置为 True

```
set_option -gen_sdf 1
```
- Generate Post-Place File 配置为 True

```
set_option -gen_posp 1
```
- Generate Post-PNR Simulation Model File 配置为 True

```
set_option -gen_sim_netlist 1
```
- Place input register to IOB 配置为 False

```
set_option -ireg_in_iob 0
```
- Place output register to IOB 配置为 False

```
set_option -oreg_in_iob 0
```
- Place inout register to IOB 配置为 False

```
set_option -ioreg_in_iob 0
```

4.2.5 run

`run` 用于运行全部流程或某个流程。本设计执行综合和布局布线流程，用 `tcl` 命令实现如下：

- 执行综合
`run syn`
- 执行布局布线
`run pnr`

4.2.6 set_device

`set_device` 可用于设置目标器件。将本设计移植到 GW1N-9C，GW1N-LV9PG256C6/I5，用 `tcl` 命令实现如下：

将目标器件修改为 GW1N-9C，GW1N-LV9PG256C6/I5

```
set_device -name GW1N-9C GW1N-LV9PG256C6/I5
```

执行完该命令，在 `console` 窗口会显示当前的 `device` 信息。

4.2.7 saveto

`saveto` 用于将当前工程设计数据保存到 `tcl` 脚本，包括当前的器件信息、设计文件和流程选项等信息。将本设计的数据保存为 `mipi.tcl`，可供之后用命令行模式运行，用 `tcl` 命令实现如下：

将当前工程设计数据保存到 `mipi.tcl`

```
saveto mipi.tcl
```

执行完该命令，会在工程文件所在路径生成 `mipi.tcl` 文件。

